

## 業 務

### 概 覽

#### 我們是誰

我們是一家領先的12英寸純晶圓代工企業，處於全球半導體價值鏈的關鍵環節。作為專業的晶圓代工服務供應商，代工企業將無晶圓、輕晶圓及垂直整合製造（「IDM」）公司的集成電路設計藍圖大規模地製成高品質的加工晶圓。

自成立以來，我們始終致力於製程技術的進步。我們的代工服務覆蓋150nm至40nm技術節點，截至最後實際可行日期已成功開發28nm邏輯芯片平台，使我們能應對對更高性能及更高能效半導體解決方案不斷演變的需求。我們的製程能力圍繞關鍵的特定應用集成電路類別，包括實現顯示控制的顯示驅動芯片（「DDIC」）、實現圖像傳感的互補金屬氧化物半導體圖像傳感器（「CIS」）以及調節及優化電源使用的電源管理集成電路（「PMIC」）。Logic IC（支持數據處理）及微控制單元（「MCU」，提供嵌入式控制）於往績記錄期間亦迅速增長。憑藉此產品組合，我們能夠支持消費電子、汽車電子、工業控制、人工智能（「AI」）、物聯網（「物聯網」）及存儲器等眾多應用。

我們將差異化製程技術與穩定製造規模結合的能力，鞏固我們於全球晶圓代工領域的地位。根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年至2025年，全球前十大晶圓代工企業中，我們的產能及收入增長速度為全球第一。根據同一資料來源，於2025年，以收入計，我們為全球第九大、中國大陸第三大晶圓代工企業。

下表為我們的業務亮點：

高質量增長	行業領導地位	研發能力
 <p><b>47.0%</b> 2020年至2025年 收入年複合增長率<sup>(1)</sup></p>	 <p><b>第三</b> 中國大陸 <b>第九</b> 全球 晶圓代工企業<sup>(2)</sup></p>	 <p><b>1,374</b>項專利 包括 <b>1,057</b>項發明專利 截至2025年12月31日</p>
 <p><b>22.7%</b> 2025年綜合毛利率</p>	 <p><b>全球第一</b> DDIC晶圓代工企業<sup>(2)</sup></p>	 <p><b>人民幣1,453.4百萬元</b> 2025年研發開支</p>
 <p><b>32.2%</b> 本公司擁有人應佔 淨利潤同比增速<sup>(3)</sup></p>	 <p><b>第三</b> 中國大陸 <b>第五</b> 全球 CIS晶圓代工企業<sup>(2)</sup></p>	 <p><b>34.6%</b> 截至2025年12月31日 研發人員佔員工總數比例</p>

附註：

- (1) 根據我們自2020年至2025年於上海證券交易所科創板所刊發的年報數據。該等數字未經審計師及申報會計師審計或審閱。

## 業 務

- (2) 根據弗若斯特沙利文的資料，於2025年按營業收入排名。
- (3) 自2024年至2025年。

### 我們的業務模式

晶圓代工行業為全球半導體價值鏈的重要支柱。依託上游提供硅晶圓、光刻膠、特種化學品、核心設備、電子設計自動化(「EDA」)工具及知識產權(「IP」)授權等必要材料及技術，晶圓代工企業為無晶圓、輕晶圓及IDM公司等集成電路設計公司提供專業的晶圓代工服務，將其集成電路設計藍圖大規模地製成高品質的加工晶圓。無晶圓公司將晶圓代工完全外包予晶圓代工企業，而具備內部集成電路製造能力的輕晶圓及IDM公司亦可與晶圓代工企業合作，以獲取專業技術、確保穩定產能並提升成本效益。該等加工晶圓隨後交付予集成電路設計公司，由半導體封測代工(「OSAT」)供應商進行封裝與測試，最終由集成電路設計公司整合至消費電子、汽車電子、工業控制、人工智能(「AI」)、物聯網(「物聯網」)及存儲器等廣泛應用領域的終端產品中。

在此價值鏈中，作為一家12英寸純晶圓代工企業，我們將銜接技術發展與大規模生產，提供低功耗、高性能的集成電路。我們的技術平台組合提供代工服務，主要包括DDIC、CIS及PMIC，而Logic IC及MCU於往績記錄期間迅速增長。我們服務多元客戶群，包括消費電子、汽車電子、智能家居、工業控制、AI、物聯網及存儲器等終端市場的無晶圓、輕晶圓及IDM公司等領先集成電路設計公司。

晶圓代工中，硅晶圓尺寸從最初的6英寸及8英寸發展至現時主流的12英寸。儘管8英寸生產線仍在支持傳統應用，但目前的增量產能增長主要來自12英寸晶圓，其表面面積為8英寸晶圓約2.25倍，良率相同時可切割出更多晶粒並降低單片晶圓成本。我們專門從事12英寸晶圓代工，實現高集成密度、緊湊組件設計及出色的電氣性能。

晶圓代工服務的技術成熟度通常體現在製程技術節點。根據弗若斯特沙利文的資料，7nm或以下的前沿節點用於高性能處理器、AI加速器、旗艦智能手機的系統級芯片(「SOC」)及先進網絡芯片，以解決計算密集型邏輯任務。介乎10nm至22nm的先進節點通常用於需要平衡性能及集成的應用，例如中端消費SOC、高端MCU、CIS及PMIC設計。工業控制、物聯網、顯示及功率器件等下游應用對半導體產品的長期可靠性及運作穩健性一向有持續且嚴格的要求，此亦支撐28nm及以上成熟節點的持續廣泛普及。就DDIC、CIS、PMIC及MCU等關鍵元件而言，成熟節點因其成熟且歷經充分驗證的製造流程而受廣泛青睞。使用該等成熟節點技術製造的芯片通常具備更厚的柵氧化層，可降低電場強度並提升電壓抗性。其相對較長的導電通道亦能在溫度與工作電壓變動下提供穩定的電氣性能。此外，成熟節點平台常集成專用的高壓元件結構，能有效分散電應力，從而在極長的運作生命週期中顯著提升元件可靠性。該等固有的技術特性使成熟節點成為安全型高壓應用的當然之選，從而維持殷切的市場需求。此外，行業表現通常基於晶圓銷量、產能及良率等關鍵運營指標進行評估。根據同一資料來源，截至最

## 業 務

後實際可行日期，我們的全面晶圓代工服務組合涵蓋多個產品類別的技術節點，使我們於國內同業中處於領先地位，DDIC達至40nm，CIS及Logic IC達至55nm，PMIC及MCU達至110nm。

通過整合製程專業知識、良率優化及成本控制，我們提供的製造平台能夠使客戶加速產品週期、確保質量穩定並實現可擴展生產。憑藉本地化運營，我們進一步鞏固我們作為可信賴代工合作夥伴的地位，幫助客戶降低供應鏈風險，並保持其運營的穩定性及確定性。

### 我們的技術實力

我們已建立150nm至40nm技術節點的量產能力。在工藝平台應用方面，我們已具備DDIC、CIS、PMIC、Logic IC、MCU等工藝平台的技術能力，形成了全面且多元化的工藝組合，支持我們在關鍵細分市場的領先地位。我們不斷提升製程技術，進一步優化了產品結構。截至最後實際可行日期，我們已開始28nm Logic IC試產，實現40nm高壓有機發光二極管顯示驅動芯片（「OLED DDIC」，一種用於控制OLED面板、具有更高精度及能源效益的DDIC）、55nm中高階背照式圖像傳感器（「背照式圖像傳感器」，具有讓光線從硅基板的背面進入以提高靈敏度及性能的傳感器架構的CIS）及55nm全流程堆棧式CIS（其垂直集成多個傳感器層以提升圖像質量及功能）量產，並正在穩步推進OLED DDIC等其他28nm晶圓代工解決方案的開發工作。

長期以來，我們始終堅持高強度研發投入，逐步構建起堅實的知識產權與技術壁壘。截至2025年12月31日，我們持有1,374項專利，其中包括1,057項發明專利，彰顯了我們自主創新的能力與成果。於2025年，我們的研發開支為人民幣1,453.4百萬元，較2024年上升13.2%。

### 我們的客戶群及供應商體系

依託堅實的技術基礎，我們獲得無晶圓、輕晶圓及IDM公司等領先集成電路設計企業的廣泛認可，並與多元化的客戶群體建立了長期而深入的合作關係。與戰略客戶的緊密協作，使我們能夠持續優化研發與代工流程，確保產品與服務時刻緊貼市場需求的演進。與此同時，我們依託穩健的供應商體系，積極提升國產設備與材料的應用比例，從而增強供應鏈韌性，並為半導體產業的本土化進程貢獻力量。

### 我們的ESG舉措

可持續發展是我們長期戰略的核心。我們秉持「關愛環境、關注氣候」的理念，將經濟、社會與環境責任融入日常運營。通過系統性的減排、節能與資源循環利用舉措，我們努力降低環境足跡，打造綠色而具韌性的供應鏈，與供應商及業務夥伴攜手共進，推動行業綠色轉型。見「一環境、社會及企業管治」。

### 我們的財務表現

於往績記錄期間，我們於行業週期中貫徹展現出穩健的表現。於2023年、2024年及2025年，總收入分別為人民幣7,182.7百萬元、人民幣9,119.6百萬元及人

## 業 務

人民幣10,388.3百萬元，同期毛利率為20.3%、25.2%及22.7%。於2023年、2024年及2025年，淨利潤分別為人民幣119.2百萬元、人民幣482.2百萬元及人民幣466.5百萬元，同期淨利潤率為1.7%、5.3%及4.5%。

近年來，全球晶圓代工行業已經歷持續的長期增長及正常的週期性調整。在疫情後復甦及供應鏈緊張的推動下，於2021年及2022年下游半導體需求激增後，行業於2023年進入存貨正常化階段，原因為整個半導體價值鏈的客戶在消費電子產品需求疲軟的情況下專注於消化高存貨水平。儘管存在該暫時調整，全球晶圓代工市場整體持續擴張，由2021年約1,002億美元增長至2025年的1,747億美元，複合年增長率為14.9%。在此背景下，我們的收入於2023年至2025年有所增加，主要由市場需求增加、豐富產品組合及規模經濟效應提升所帶動。據弗若斯特沙利文告知，董事認為，我們的財務表現大致維持穩定，與整體市場動態一致。按此基準，獨家保薦人概不知悉有任何事宜令獨家保薦人不同意董事的意見。

展望未來，董事認為半導體市場的需求將維持強勁，尤其是在我們運營所在的成熟節點領域。支持性政府政策及結構性拓展的下游應用預計將支撐行業的穩定發展。具體而言，汽車電子、AI及機器人的增長不斷提升每件設備的半導體含量，其中PMIC、MCU及DDIC主要採用成熟節點製造，支持持續需求及穩健的供需動態。見「行業概覽—全球晶圓代工市場」。

### 我們的競爭優勢

**我們是快速成長的全球前十大晶圓代工企業，提供廣泛的工藝平台**

我們是一家領先的12英寸純晶圓代工企業，擁有快速擴張與技術創新的卓越實績。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年至2025年期間，全球前十大晶圓代工企業中，我們的產能和營收增長速度為全球第一，使我們佔據全球行業中最具成長性的地位。根據同一資料來源，按照2025年營收統計，我們是全球第九大、中國大陸第三大晶圓代工企業。

2015年成立以來，我們不斷推動工藝水平進步，代工製程節點從最初的150nm至110nm拓展到150nm至28nm，工藝平台從最初的DDIC拓展到DDIC、CIS、PMIC、Logic IC及MCU等各類組合。我們在技術節點和產品平台上的進步，使我們能夠滿足各種產品性能與成本控制方面的需求，同時成功切入多個下游市場。各技術平台均針對特定終端市場度身定制，例如用於電視、車載顯示及電腦顯示屏的DDIC；用於智能手機、工業視覺及汽車電子的CIS；用於工業設備及其他消費電子的PMIC；用於圖像信號處理器及閃存控制器的Logic IC；及用於智能家電的MCU等，確保實現廣泛且均衡的市場覆蓋。根據弗若斯特沙利文的資料，2025年，按收入計，150nm至28nm技術節點的集成電路產品市場規模佔全球集成電路市場的大部分，約為59.6%。我們的組合涵蓋主流節點及主要集成電路類別，能抓住消費電子、汽車電子、智能家居、工業控制、AI、物聯網及存儲器等領域蓬勃發展的市場機遇，同時不斷受益於中國大陸半導體供應鏈加速國產替代的趨勢。

在工藝平台的組合中，我們於DDIC與CIS領域均展現出全球領導地位。根據弗若斯特沙利文的資料，2025年，按收入計，我們是全球最大的DDIC晶圓代工企業，佔0.9%的市場份額。根據同一資料來源，2025年，按出貨量計，全球

## 業 務

約23.3%的新增電視、平板、筆電由我們的DDIC解決方案點亮。我們亦於2025年開始40nm高壓OLED DDIC的量產，截至最後實際可行日期，正穩步推進28nm OLED DDIC平台的開發以支持新一代OLED顯示器。根據弗若斯特沙利文的資料，我們是中國大陸第三、全球第五的CIS代工企業，全球市場份額為7.1%。我們的55nm中高階背照式圖像傳感器及全流程堆棧式CIS平台支持高像素圖像傳感器，已於主流中高端智能手機主攝像頭的供應鏈採用。我們推出的高像素CIS解決方案已成為高端手機的重要選擇，車規級DDIC和CIS平台已通過AEC-Q100認證。

在此強大基礎上，我們繼續擴展PMIC、邏輯芯片、MCU等其他產品平台。相較於仍聚焦單一製程環節的國內同業，我們領先的製程覆蓋範圍、廣泛的產品平台及強大的產能共同拓寬目標市場，並增強於滿足下游客戶不斷變化的需求方面的靈活性，使我們躋身全球十大代工企業之列，並於塑造半導體行業的未來發展軌跡方面持續發揮作用。

### 我們與全球領先的芯片設計客戶建立了緊密穩固粘性強的業務關係

我們與無晶圓、輕晶圓及IDM公司等全球領先集成電路設計公司建立了緊密穩固粘性強的業務關係。無晶圓公司主要專注於芯片設計，並無自主製造能力。輕晶圓公司保留有限產能，而將大部分晶圓製造外包予代工企業，以優化成本及產能利用率。同時，越來越多IDM公司與外部代工企業合作，以提高生產規劃的靈活性並確保各產品線的供應彈性。透過將可靠及可預測的產能保證與定制化技術平台開發相結合，我們為客戶提供在快速發展的終端市場中競爭所需的確定性及靈活性，進一步使我們能獲取寶貴的客戶洞察及市場需求。我們能緊貼客戶策略，預測市場轉變，使我們能夠於往績記錄期間保持客戶留存率約99.0%，足證我們所建立的粘性極強，合作關係穩固。

**可靠及可預測的產能保證。**我們的合作關係建基於我們於DDIC及CIS晶圓代工的領先地位。我們是領先的DDIC設計公司值得信賴的代工合作夥伴，為智能手機、平板電腦、電視及車載顯示等各種下游應用提供OLED及LCD DDIC。在CIS領域，我們與中國頂尖圖像傳感器設計公司緊密合作，支持55nm堆棧式CIS平台的開發及量產，該平台可支持高像素圖像傳感器。

**定制化產品開發提升質量及客戶粘性。**憑藉DDIC、CIS及其他專業技術平台，我們從設計支持的早期階段便與客戶合作直至量產，共同開發及驗證定制化工藝流程以滿足特定應用需求。此聯合開發模式使我們能縮短產品上市時間並提升整體產品性能。我們對客戶產品路線圖的深度參與增強合作粘性，從而提高轉換成本，確保在多個產品世代中獲得經常性訂單。許多關鍵客戶與我們保持長期合作，並不斷擴大合作範圍及規模，彰顯高度信任及我們支持產品持續升級迭代的能力。

**深度客戶合作助力精準把握市場需求。**我們充分利用中國大陸完善的產業鏈，和領先的集成電路設計公司及終端產品製造商進行密切穩定的交流，並積極參加行業對話及技術研討會，預計設計需求變化，確保製程路線圖時刻切合市場發展。

## 業 務

### 智能生產和本地化產業鏈優勢確保更高經營效率和成本效益

我們的代工能力由高度一體化的生產基地、智能生產及本土化供應鏈支持，使我們具備更高效率、更佳質量及更雄厚的成本競爭力。

**一體化生產基地。**有別於分散式晶圓代工，我們的全部產能位於合肥市的同一個廠區內。我們在廠區規劃設計之初就充分考慮了中遠期產能擴充與協同適配，通過在同一廠區內有序、穩定地擴充產能，我們能夠減少不必要的重複建設，最大化充分利用各項設備和設施。生產基地內部署自動化晶圓傳送系統，以在集中管理下創造出一套一體化製造流程。

**智能智造體系。**我們已整合智能製造系統及AI工具，持續優化設備性能、資源分配和工藝參數，從而在多個方面實現顯著提升，包括加工速度加快、設備維護效率提升、製程參數調校時間縮短及設備運行時間增加。我們於多個關鍵環節部署創新算法，有效提升設備利用率與產能效益，大幅縮短良率爬坡週期。

**本地化供應鏈。**我們充分借助中國大陸半導體生態快速發展機遇，積極努力推動關鍵原材料、設備及設計支持軟件的國產化。於往績記錄期間，我們已穩步提升晶圓、氣體及化學品的國產化，已在光刻、刻蝕、沉積、擴散及測量等核心環節導入多家領先國產設備供應商，並持續積極開展新供應商和新設備的驗證，我們持續推動國產替代，降低對進口材料及設備的依賴，此舉顯著縮短採購及交付週期、降低整體採購成本並增強供應鏈穩定性，從而提升市場響應速度，令我們在行業週期中實現可持續增長。

### 我們具備強大的研究及開發能力，可以持續進行技術產品迭代

我們的研發團隊核心成員均由境內外資深專家組成，其中多名成員曾在全球知名代工企業擔任領導職務。自2017年首次實現量產以來，我們的研發工作取得顯著進展，實現了製程從110nm向40nm的研發迭代，28nm Logic IC已開始試產，這一里程碑為高性能應用中的廣泛採用奠定基礎。在DDIC、CIS及邏輯芯片平台上，我們專注於提升核心性能屬性，包括能效、信號傳輸及數據處理能力，以滿足全球頂尖設計公司的期望。

另一方面，注重特殊工藝的開發，持續提升我們的平台的差異化和競爭力。截至最後實際可行日期，除28nm Logic IC試產外，我們已實現40nm高壓OLED DDIC、中高階55nm背照式圖像傳感器及55nm全流程堆棧式CIS量產。該等技術進步為各類消費、工業及智能設備應用帶來更穩定的顯示性能、更清晰細膩的圖像捕捉以及更高效的數據處理能力。截至2025年12月31日，我們持有專利1,374個，其中發明專利1,057個、實用新型專利317個，顯示我們獨立創新的強大實力。

### 我們擁有經驗豐富的管理團隊和多元完善的股東結構

我們的管理層由來自中國大陸和中國台灣地區的資深半導體行業專業人士組成，具備一線晶圓代工企業的經營管理經驗，行業從業年限超過30年。管理團

## 業 務

隊有能力掌控複雜的運營，預測行業週期，為我們提供強大持續的領導力和戰略視野。我們視人才為競爭中具決定性作用的推動因素。我們通過多樣化的績效評價體系、長期激勵機制及度身定制的培訓方案建立員工與本公司之間的長期聯繫，實現共同發展激勵，確保有效留聘主要人才，亦培養未來的人才儲備。

我們的股東基礎包括中國合肥市國有資本、中國台灣半導體產業領先投資人、中國大陸原始設計製造商（「ODM」）產業知名投資人等，相輔相成。該股東結構穩定，具備豐富資源，並以市場為導向，為我們提供強而有力的戰略支持、行業知識和長遠財務穩定性，支持我們可持續發展，同時保留獨立性和運營靈活性。

### 我們的戰略

#### 多元工藝平台佈局，技術迭代打開新增長曲線

我們將持續專注集成電路晶圓代工服務，致力於為國內提升自主集成電路製造能力貢獻力量。具體而言，我們希望在保持我們作為2025年全球收入第一的DDIC晶圓代工企業的同時，提升CIS的全球市場份額，並且開拓新產品應用領域，實現新增長機遇。

我們計劃拓展現有技術平台的應用範圍，以把握消費電子、汽車電子、微顯示及人工智能等快速增長的高價值下游市場的增量市場需求。儘管該等市場不斷發展，其功能性集成電路的大部分需求仍集中於成熟節點，這對於重視可靠性、成本效益及長產品生命週期的應用至關重要。隨著系統越來越複雜，客戶日益採用異構架構，將先進處理器與成熟節點芯片配對，以實現電源管理、顯示驅動、傳感、連接和控制功能，從而支持成熟節點技術持續且多樣化的增長機會。見「行業概覽」。

為實現該等商機的商業化，我們持續優化OLED DDIC平台以支持高性能及柔性顯示應用，同時升級CIS及PMIC等其他技術平台，以滿足不斷擴大的智能家居及物聯網市場需求。在新能源汽車領域，我們戰略性地開發核心車規級平台，包括DDIC、CIS、PMIC及MCU，打造極為可靠的集成電路晶圓代工解決方案，支持電動化、網聯化、智能化趨勢。在微顯示應用領域，我們積極發展DDIC平台，以涵蓋VR及AR眼鏡以及抬頭顯示器等用例。在更廣泛的AI生態系統中，雖然超級計算機仍集中於前沿節點，但我們正透過優化工藝平台及引入輔助元件與模塊（例如用於計算機服務器的PMIC），以把握成熟節點的需求。

#### 完善技術體系，高效研發引領持續創新

我們一如既往地高度重視技術平台的持續開發及升級，聚焦核心製程技術，並響應成熟及新興應用市場不斷變化的客戶需求。截至最後實際可行日期，我們已完成28nm邏輯芯片平台的平台開發並進入試產，並計劃進一步將Logic IC技術延伸至22nm製程能力，以把握22nm技術平台的廣闊市場機遇。

## 業 務

我們正透過採用智能及數據驅動技術研發系統，以強化設計、製造與客戶需求間的協同。升級後的系統整合數據分析、智能建模及自動化製程控制，可提升研發全流程的透明度、預測能力及響應速度。透過從回溯性數據分析逐步邁向主動風險識別及精準對接客戶需求，該系統能實現更高效的設計迭代，加速從研發到量產的轉化。借助AI賦能的設計—製造協同優化及多智能體協調技術，我們致力於在研發全流程實現自主決策及全域優化。通過在研發人才、研發設備、研發系統以及知識產權成果保護等方面的持續投入，我們將進一步構建技術壁壘及競爭力，為工藝平台擴張和全球市場拓展提供持續創新動能。

### 有序擴充產能，智能製造驅動生產效率提升

基於對全球半導體市場結構性增長機遇的研判，我們將根據終端市場需求有序實施產能擴張，以期實現供給能力與客戶需求的動態平衡。憑藉2021年成功實現平均月產能從3萬片到10萬片的寶貴經驗，我們已構建起具有快速響應能力的彈性產能體系。截至2025年12月31日，我們實現每月137.9千片12英寸晶圓的設計產能及139.0千片晶圓的實際產量，產能利用率達100.8%。未來，我們將逐步推進研發中技術平台量產，持續優化靈活高效的產能配置，提升規模經濟效益並增強成本競爭力。就此，我們於2024年3月與關連人士合肥藍科投資有限公司訂立土地轉讓協議，當中我們購入土地使用權及該土地上的在建項目(包括廠房建築物、構築物及生產廠房)，以進一步擴大產能。見「一物業—自有物業」。

我們重視智能製造為生產效率帶來的積極變化。我們積極部署智能製造相關系統，整合AI工具以減少設備停機時間、優化資源配置、縮短生產週期，從而提升產出量並降低單位生產成本。我們亦計劃透過優化生產規劃、提升良率、加強生產過程管理及提高產能利用率，從而提升生產效率。

與此同時，我們認為綠色製造應與生產效益協同共進，其履行環境責任，並進一步創造新的商業價值和競爭優勢，確保可持續的盈利能力。為實現自2025年至2030年碳排放密度每年降低2%的目標，我們正積極引入智能節能系統、優化設備效率，並大幅提升綠色電力的使用。

### 區位優勢轉化，產業鏈生態圈實現價值共生共贏

我們一直積極將業務融入區域產業生態系統。作為合肥市一體化發展戰略的一部分，合肥市已建立以「芯屏汽合」倡議為核心的獨特產業格局，將集成電路產業列為戰略性新興產業。合肥市現已集聚幾百家產業鏈上下游重點企業，形成了從集成電路設計、製造、封裝測試、設備材料到公共服務平台的完整生態系統。作為一家集成電路晶圓代工企業，得益於合肥市蓬勃發展的產業生態系統，我們將持續深化客戶導向戰略，一方面深度對接本地龍頭企業需求，另一方面積極吸

## 業 務

引優質客戶落地、落項合肥。我們將利用安徽省汽車產業集聚的區位優勢，與多家本地車企建立合作開展技術平台開發，強化公司的區域產業協同優勢，為長期可持續發展奠定堅實基礎。

在供應鏈管理方面，我們始終推動供應鏈本土化，並將其拔高到公司戰略層面，我們自成立以來一直致力於與本地上下游公司緊密合作，並推動國內優質的設備商、EDA軟件(其提供用於集成電路設計及驗證的電腦輔助工具)供應商以及材料供應商的廠內驗證。未來，我們也將堅定做好「煉金廠」角色，通過採用嚴格、前瞻性的標準，推進供應商群的持續質量改善及技術進步，持續提升半導體產業鏈的國產化率。我們堅信，本地供應商的強大支持將助力構建更具韌性和安全性的半導體行業供應鏈體系。

### 推進全球化戰略，國際化經營理念把握發展新機遇

我們始終堅持國際化經營理念，持續推進全球化戰略布局，以把握全球集成電路市場持續擴張所帶來的發展機遇。

我們著力於推動銷售網絡的全球化布局。我們深耕現有海外市場，通過提升技術平台和服務質量來增強競爭優勢及強化客戶粘性。此外，我們重點發展與全球知名龍頭企業的戰略合作，以標桿客戶效應帶動全球品牌影響力的躍升。我們計劃提升在亞洲及歐洲發達經濟體市場的影響力，通過獲取新客戶開闢新市場，進而提升我們全球市場份額。

我們計劃於中國香港設立研發銷售中心，充分利用其國際化區位優勢和豐富人才資源，更加貼近亞太市場需求，加速工藝平台商業化落地。該中心將使我們與全球技術前沿及區域市場接軌，並通過中國香港開放的商業環境和健全的金融平台，加強與客戶的合作，吸引國際頂尖人才。

「China for China」戰略已成為全球半導體產業的重要趨勢，國際IDM大廠(其自主設計、製造及銷售半導體)紛紛著手在中國市場建立本土供應鏈體系，將其部分產品交由中國晶圓代工企業生產。作為晶圓代工企業，憑藉國際化的經營理念與本土化的供應鏈及人才優勢，我們將積極發展與國際IDM大廠的戰略合作，服務中國市場，構建全球半導體產業發展新格局。

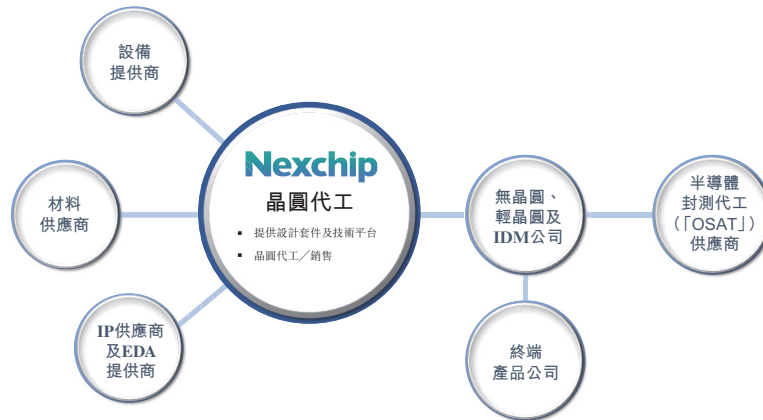
### 我們的業務

作為一家領先的12英寸純晶圓代工企業，我們戰略性立足於半導體價值鏈的核心，為集成電路設計公司提供將芯片設計轉化為低功耗、高性能的代工芯片的專業晶圓代工服務。通過銜接技術發展與大規模生產，我們提供晶圓代工服務及提供廣泛應用於消費電子、汽車電子、智能家居、工業控制、AI、物聯網及存儲器的產品。我們專門從事12英寸晶圓代工，以實現高集成密度、緊湊組件及出色性能。相較於小尺寸晶圓，12英寸晶圓基板具備更高的製造效率，尤其適合需要大晶圓面積、更多有效晶粒或嚴格製程控制的設計。

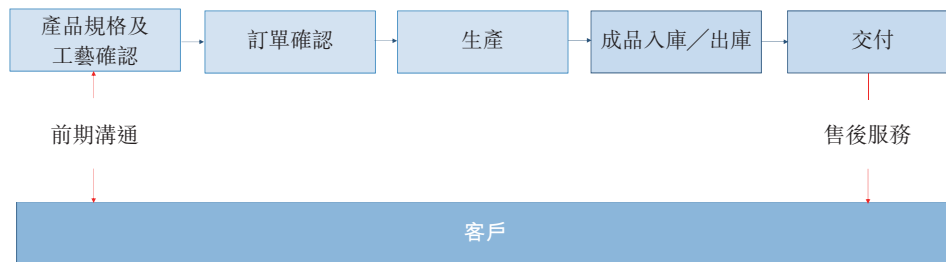
## 業 務

我們提供從設計支持、晶圓代工到售後服務的代工服務。為支持可量產且高效率的芯片設計，我們與廣泛合作夥伴生態系統密切合作，包括設備提供商、原材料供應商、IP供應商及EDA提供商，並已建構工藝設計套件(「PDK」)及IP庫，以支持與客戶協同設計流程。加上專業的代工製造流程，我們提供針對客戶特定性能的量身定制解決方案，進一步加速產品上市週期，並確保量產的可擴充性。

下圖說明我們在半導體價值鏈中的角色以及我們與主要生態系統合作夥伴的合作：



下圖展示我們的業務流程：



我們的業務流程涵蓋從設計支持到晶圓代工、測試、倉儲及交付的完整價值鏈。業務流程主要包含以下階段：

- **預購溝通及訂單確認**(耗時因客戶需求而異)。初期階段，銷售及營銷團隊與客戶合作以確認需求，而研發團隊則評估技術可行性。客戶可在此階段通過EDA工具鏈採用第三方或自研IP核，我們則按需要與IP供應商及EDA供應商協調技術一致性。待製程規格、定價及交付時間表達成一致後，訂單即獲確認並安排生產。
- **生產**(通常為1至3.5個月)。訂單確認後，生產及工程團隊執行晶圓代工及測試，供應商提供設備及材料支持，質量團隊進行質量檢測及產品放行，而工程團隊則為製程優化及問題解決提供支持。

## 業 務

- **成品入庫／出庫及交付** (通常為1周)。生產後，物流團隊協調包裝及透過經批准的物流供應商交付至客戶或指定的OSAT供應商，而銷售及客戶服務團隊則與客戶保持溝通，以確保準時交付及解決問題。
- **交付後協作及技術回饋** (通常按持續基準)。交付後，技術支持團隊持續與客戶 (及其OSAT或終端產品合作夥伴 (如適用)) 協作，共同評估製程成果。此回饋迴路所產生的洞察將分享予研發及生產團隊，以推動製程持續改良。

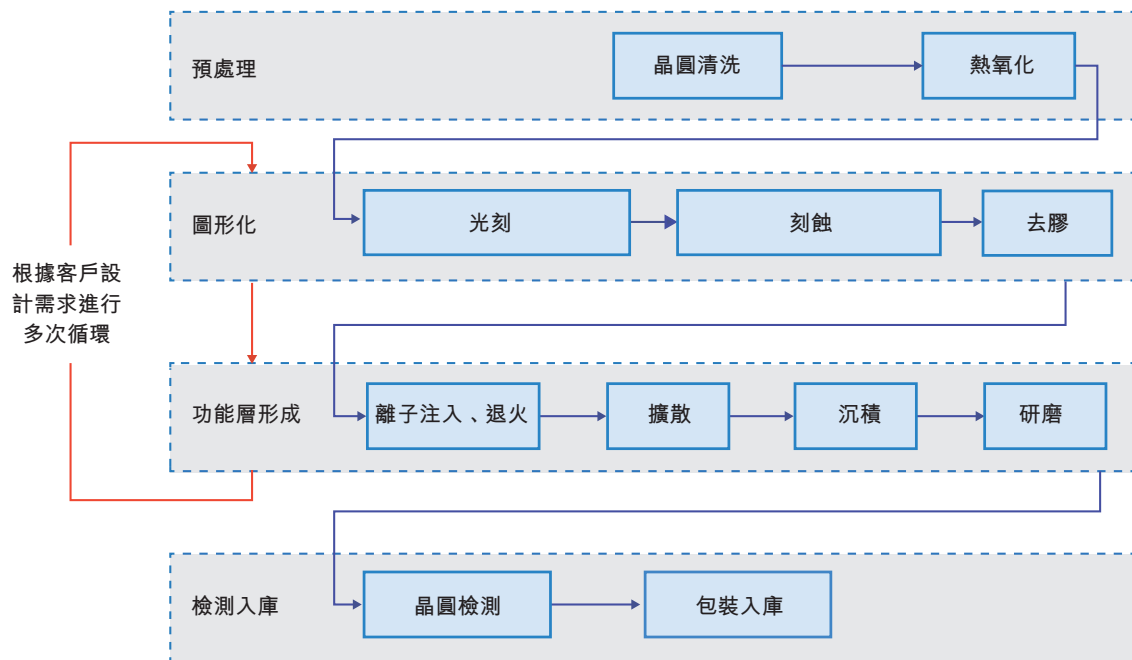
## 我們的生產能力

### 概覽

我們在安徽省合肥市經營一個專注於12英寸晶圓代工的大規模集成生產基地，將生產設施集中在單一製造園區內。截至最後實際可行日期，生產基地支持150nm至40nm技術節點的各類產品生產。截至2025年12月31日，生產基地的總建築面積約為387,007.6平方米，於2025年，12英寸晶圓的平均月產量為139.0千片。我們的生產基地配備的晶圓代工設備、精密測量系統及智能製造系統，可實現多個技術平台之間的資源無縫協調及運營協同。

### 我們的晶圓代工流程

晶圓代工涉及一系列精確控制的複雜工藝步驟，將原始硅片轉變為全功能半導體芯片。我們的生產週期通常為期1至3.5個月，視乎產品類型、技術節點及生產製程複雜程度而定。製造流程可分為以下階段：

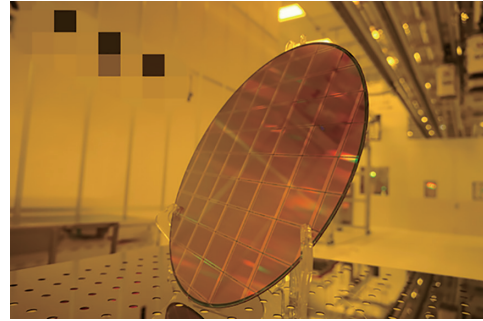


## 業 務

- **預處理**。該過程從晶圓清洗開始，以於高溫處理前去除任何表面污染物。關鍵材料包括多種酸、過氧化氫及高純度去離子水，主要設備則包括自動濕式工作台及晶圓刷洗機。
- **圖形化**。光刻是在晶圓上圖形化集成電路的核心工藝，涉及三個主要步驟：用光刻膠塗覆晶圓，通過光罩將其曝光以轉移電路圖形，以及顯影晶圓以顯示圖形。此步驟會重複多次，並使用光阻劑、顯影劑、溶劑及超平坦石英光罩。關鍵設備包括旋塗機、掩模對準機或步進／掃描系統以及自動顯影機。我們隨後進行刻蝕，使用各種方法選擇性地去除未保護的材料。視乎材料層，可選擇性採用乾法蝕刻(包括電漿及反應離子蝕刻)及濕法化學蝕刻。該等製程使用蝕刻氣體(如四氟化碳、六氟化硫或氟氣混合物)及液體蝕刻劑(如緩衝氧化物溶液)。有關步驟於配備排氣及污染控制系統的高精度電漿蝕刻機及濕式處理站中進行。
- **功能層形成**。離子注入在真空和低溫下將硼、磷或砷等特定摻雜劑離子引入晶圓的指定區域。此步驟使用離子植入機設備及高純度摻雜氣體源(包括乙硼烷、磷化氫及砷化氫)執行。我們實施高溫退火修復晶格損傷及調整晶圓的電性能。退火於快速熱處理爐或擴散爐中在 $900^{\circ}\text{C}$ 至 $1,050^{\circ}\text{C}$ 溫度下進行。在擴散過程中，摻雜劑離子在高溫下於晶圓內部遷移，形成具有不同電特性的區域。化學氣相沉積(「**化學氣相沉積**」)通過氣體前體的化學反應在晶圓表面沉積固體薄膜，而物理氣相沉積(「**物理氣相沉積**」)則採用濺射或蒸發等技術以物理方式沉積薄膜。化學氣相沉積通常使用硅烷( $\text{SiH}_4$ )、氨( $\text{NH}_3$ )或二氯硅烷( $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$ )等氣體，並於低壓或電漿增強化學氣相沉積反應器中進行。物理氣相沉積使用金屬靶材(如鋁、銅、鈦)及濺射或蒸發腔室。化學機械研磨(「**化學機械研磨**」)結合機械研磨與化學反應，對晶圓表面進行平坦化處理，以確保後續層次所需的平整度。化學機械研磨涉及使用拋光墊、研磨液(硅基或鋁基)及高精度化學機械研磨工具。
- **檢測入庫**。在晶圓加工完成後，會使用探針台及其他檢測設備進行電氣及功能測試，以驗證是否符合客戶規格。典型測試階段包括參數測試、晶圓分揀及缺陷檢查，使用自動測試設備、光學檢測系統及探針卡。通過檢測的晶圓將真空封裝及儲存以供交付。包裝材料包括防靜電載具及真空密封袋，儲存環境需控制溫度及濕度。

## 業 務

下圖展示硅晶圓及我們的晶圓產品：

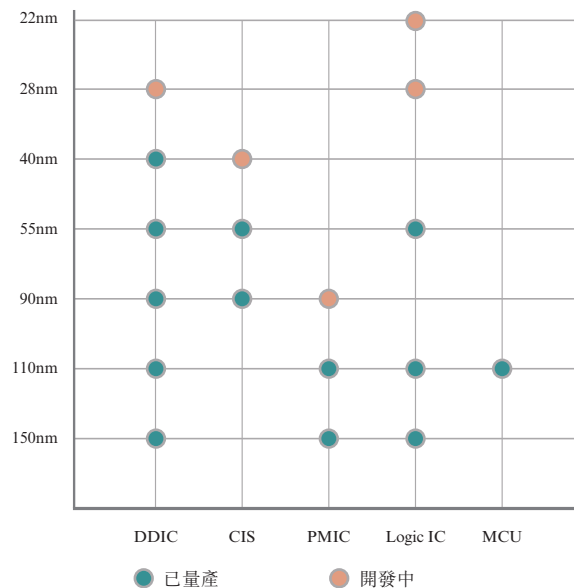


### 我們的技術平台

我們已開發一套技術平台，集成製程技術、器件架構及製造能力，以支持在12英寸晶圓上生產各式各樣的集成電路產品。我們的製程技術指在不同技術節點採用的半導體製造流程。器件架構包括對晶體管、存儲器單元及類比模組等功能元件的集成，以切合終端使用需求。

我們的技術平台組合主要支持DDIC、CIS及PMIC代工，而Logic IC及MCU於往績記錄期間迅速增長。建基於150nm至28nm的多元化技術節點，每個平台均配置應用特定的製程模組及豐富的器件選項，例如高壓晶體管、嵌入式非易失性存儲器及成像結構，以滿足不同終端應用的功能需求，提高產品性能、成本效益及設計靈活性。該等平台構成代工服務的基礎，使我們能夠在廣泛的應用中提供最佳的功率性能、全面提升的處理速度、集成密度及可製造性。

下圖列示我們截至最後實際可行日期主要技術平台的開發狀況：



## 業 務

下表載列我們於所示期間按技術節點劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)					
150nm.....	960,726	13.4	1,409,180	15.5	1,979,799	19.1
110nm.....	2,188,688	30.5	2,446,519	26.8	2,796,822	26.9
90nm.....	3,469,754	48.3	4,362,854	47.8	4,461,425	42.9
55nm及以下.....	563,576	7.8	898,463	9.9	1,118,489	10.8
其他 <sup>(1)</sup> .....	-	-	2,564	0.0	31,767	0.3
<b>合計.....</b>	<b>7,182,744</b>	<b>100.0</b>	<b>9,119,580</b>	<b>100.0</b>	<b>10,388,302</b>	<b>100.0</b>

附註：

(1) 其他包括光罩。

### 產能

在生產基地支持下，我們已建立晶圓代工能力。為滿足不斷增長的市場需求並提升我們的市場競爭優勢，我們已訂立土地出讓協議收購位於安徽省合肥市的土地使用權及該土地上的在建項目，以於未來幾年將月產能進一步擴大約50,000片12英寸晶圓。見「業務－物業－自有物業」。我們透過需求驅動的系統管理產能，該系統依託涵蓋從研發階段到試產、風險生產及量產階段的跨部門規劃。我們檢討設備利用率、完善流程，並升級設備及工具以提升產能及回應客戶不斷變化的需求。我們亦根據工廠利用率調整訂單承接，優先安排支撐整體盈利能力的產品及客戶。

下表載列我們的生產基地於所示期間的產能、產量及產能利用率：

	截至12月31日止年度								
	2023年			2024年			2025年		
	設計 產能 <sup>(1)</sup>	實際 產量 <sup>(2)</sup>	產能 利用率 <sup>(3)</sup>	設計 產能 <sup>(1)</sup>	實際 產量 <sup>(2)</sup>	產能 利用率 <sup>(3)</sup>	設計 產能 <sup>(1)</sup>	實際 產量 <sup>(2)</sup>	產能 利用率 <sup>(3)</sup>
	(千片)		(%)	(千片)		(%)	(千片)		(%)
	1,320.5	957.4	72.5 <sup>(3)</sup>	1,444.7	1,357.2	94.0	1,654.5	1,667.6	100.8

附註：

(1) 我們的設計產能是一個綜合性的計算基準，其在綜合考慮特定工藝平台組合、設備的計劃性維護與潛在故障時間、新機台的正式投產時間以及瓶頸機台的工藝約束等因素後釐定。通過對這些變量的持續優化和運營管理，我們的實際產出可能超越靜態的設計產能目標。於往績記錄期間，我們開始使用新生產設備，以不斷擴大產能。於2023年、2024年及2025年，平均設計月產能(以相應年度的設計產能換算)分別為110.0千片、120.4千片及137.9千片。

## 業 務

- (2) 實際產量為特定年度內代工的晶圓實際數目。於2023年、2024年及2025年，平均實際月產量(以相應年度的實際產量換算)分別為79.8千片、113.1千片及139.0千片。
- (3) 年內或期內產能利用率按實際產量除以同期設計產能計算。於2025年，我們的產能利用率相對較高，主要因為市場需求上升。

### 製造設備及系統

我們運作的智能製造系統配備用於光刻、刻蝕、沉積、擴散、測量及檢測的先進製程設備，以及自動化控制系統。我們的數字基礎設施集成自動物料處理、製造執行系統及AI工具，以減少人為干預、優化生產排期，並實現實時質量監控。於2025年，我們因在智能製造領域的卓越努力，被認定為「安徽省先進級智能工廠」。我們按照預先制定的計劃對所有主要設備進行定期保養，並針對每件工具的運作要求制定專屬程序。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無因設備、機器或機械故障而發生任何重大或長時間生產運作中斷。

### 我們的晶圓代工服務

我們主要提供DDIC、CIS及PMIC的晶圓代工服務，而Logic IC及MCU於往績記錄期間迅速增長。該等集成電路是實現消費電子、汽車電子、智能家居、工業控制、AI、物聯網及存儲器等多元終端市場關鍵功能的重要元件。通過實現150nm至40nm主流技術節點的量產和推進28nm的研發，我們為客戶提供可擴展、具成本效益及高質量的製造基礎，實現高效量產產品，加快上市時間。於2023年、2024年及2025年，我們的晶圓總出貨量分別為935.9千片、1,366.6千片及1,624.7千片12英寸晶圓。

下表載列我們於所示期間按業務線劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)					
集成電路晶圓代工	7,182,744	100.0	9,117,016	100.0	10,356,535	99.7
DDIC .....	6,090,289	84.8	6,155,358	67.5	6,031,364	58.1
CIS .....	433,399	6.0	1,574,237	17.3	2,352,195	22.6
PMIC .....	434,015	6.0	802,449	8.8	1,262,729	12.2
其他集成電路 <sup>(1)</sup> ...	225,041	3.2	584,972	6.4	710,247	6.8
其他 <sup>(2)</sup> .....	-	-	2,564	0.0	31,767	0.3
合計 .....	<b>7,182,744</b>	<b>100.0</b>	<b>9,119,580</b>	<b>100.0</b>	<b>10,388,302</b>	<b>100.0</b>

附註：

- (1) 其他集成電路主要包括Logic IC、MCU及分立器件。
- (2) 其他包括光罩。

## 業 務

下表概述我們截至最後實際可行日期的主要集成電路服務組合、集成電路功能及主要下游應用：

服務(技術平台)	集成電路功能	主要下游應用
DDIC (150nm至40nm).....	<ul style="list-style-type: none"> <li>對顯示面板進行精確控制及管理，實現高品質視覺輸出</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電視、車載顯示、筆記本電腦、電腦顯示屏、智能手機、智能平板、可穿戴設備、電子紙等</li> </ul>
CIS (90nm至55nm) .....	<ul style="list-style-type: none"> <li>擷取光學圖像並將其轉換為電子信號，提供高分辨率成像能力。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>智能手機、工業視覺、汽車電子</li> </ul>
PMIC (150nm至110nm).....	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理及調節電源供應，確保為電子系統穩定且高效地配電。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>智能手機及其他消費電子、工業設備、汽車電子產品</li> </ul>
Logic IC (150nm至110nm、55nm) .....	<ul style="list-style-type: none"> <li>執行數字邏輯處理及信號控制，促進先進數據管理及系統集成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>圖像信號處理器、閃存控制器</li> </ul>
MCU (110nm) .....	<ul style="list-style-type: none"> <li>執行嵌入式控制及處理功能，支持各類應用的智能操作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>智能家電、物聯網</li> </ul>

有關中國該等技術平台的行業主流節點範圍，見「行業概覽—全球晶圓代工市場—晶圓代工行業概覽」。

### DDIC

我們為電視、智能手機、平板電腦及其他消費電子的平板顯示器所用的各類DDIC提供代工服務，其於往績記錄期間仍為我們最大的收入來源。DDIC對控制像素啟動電壓及時序至關重要，並需要高壓製程模組方能有效驅動顯示像素。先進的DDIC產品要求高集成密度，以有限的芯片空間容納複雜的控制功能，尤其是在移動及高像素顯示的應用上。截至最後實際可行日期，我們為150nm至40nm主流技術節點的DDIC提供晶圓代工服務，支持一系列顯示驅動的應用，各節點可針對高像素智能手機、平板電腦及電視顯示器等特定終端需求量身定制。

於往績記錄期間，我們主要提供LCD DDIC，其通過控制液晶排列以調節背光燈光，從而生生成圖像。我們積極推進針對高增長垂直領域開發量身定制DDIC解決方案。OLED面板採用有機發光二極管，可提供更佳畫質及能源效益，呈現鮮艷色彩，採用超薄設計，達致快速響應、廣視角及柔性顯示形態。市場對OLED面板需求上升，有望推動作為OLED面板核心控制單元的OLED DDIC出貨量增長。為積極鞏固我們在OLED DDIC市場的地位，截至最後實際可行日期，我們已開始40nm高壓OLED DDIC的量產，並在開發先進28nm OLED DDIC平台方面取得穩步進展。此外，我們亦積極推進針對增強現實／虛擬現實及可穿戴領域以及針對汽車電子的車規級DDIC的硅基微型OLED技術。該等發展顯著提升我們服務新興終端市場日益多元化的及專業顯示需求的能力。

## 業 務

憑藉我們成熟的高壓平台能力、卓越大規模生產往績記錄及消費電子的鞏固客戶基礎，我們已躋身成為全球DDIC晶圓代工服務的領導者。隨著我們的OLED DDIC平台不斷成熟並過渡至量產，我們已準備就緒應付客戶不斷變化的需求，並於日益擴大的動態DDIC市場中把握增長機遇。

### CIS

CIS作為核心視覺組件，廣泛應用於智能手機主攝像頭、汽車攝像頭模塊及工業視覺。CIS產品通常需要先進成像結構、複雜像素架構及高水準的模擬數字集成，因此需要嚴格的工藝要求及嚴謹的瑕疵控制。

憑藉我們成熟的90nm及55nm技術平台，我們支持主流高性能CIS生產。截至最後實際可行日期，我們已實現中高端智能手機主攝像頭所用90nm CIS產品、55nm中高階背照式圖像傳感器及55nm全流程堆棧式CIS量產，產品分辨率高達五千萬像素。此外，我們正穩步推進40nm CIS產品的技術開發，以支持客戶對具備更高分辨率及更高能源效益的新一代圖像傳感器解決方案的需求。

隨著智能手機、新能源汽車、增強現實／虛擬現實及機器視覺等市場越來越受青睞，CIS市場有望持續增長。我們專注擴大於圖像傳感器領域的份額，旨在成為該領域內最大國內代工供應商。憑藉技術平台及製造能力，我們已做好準備，把握CIS市場持續轉型及擴展帶來的重大機遇。

### PMIC

PMIC為高度整合的半導體芯片，為多種電子系統提供全面的電源管理解決方案。其執行電源轉換、電壓調節、定序及監控等基本功能，充當電子產品內電源與配電的中心樞紐。PMIC為直接影響現代電子裝置的性能、效率及可靠性的不可或缺元件，且廣泛用於電氣及電子系統。截至最後實際可行日期，我們已實現150nm及110nm PMIC產品平台量產，並正積極進行90nm PMIC的開發，進一步擴展我們的覆蓋範圍至額外應用領域。

隨著電子產品變得更多元化，且能效要求變得越加嚴格，預期PMIC於實現高性能、高能效及可靠的電子系統方面發揮更加關鍵的作用，尤其是在AI、大數據及物聯網等迅速增長市場的應用。我們於電源管理技術方面的持續創新使我們能夠抓住該等行業趨勢帶來的重大機遇，並加強我們於PMIC領域的競爭優勢。

### 其他集成電路

我們多元化的技術平台亦包括Logic IC及MCU，特點是功能出色及集成度高。通過持續革新技術平台，我們已準備就緒，為消費電子、汽車電子、智能家居、工業控制、AI、物聯網及存儲器領域等增長潛力巨大的廣泛下游應用提供支持。

- **Logic IC**。150nm、110nm及55nm技術平台的Logic IC旨在提供更高的品質及產品差異化，支持視頻系統級芯片、圖像處理、高速數據傳輸及

## 業 務

無線通信等廣泛的應用。截至最後實際可行日期，我們開始試產28nm Logic IC，進一步鞏固我們的技術基礎，使我們能夠把握汽車及更廣泛的電子產品市場的機遇。

- **MCU**。我們的MCU建基於專有110nm加強型微控制器平台。MCU廣泛應用於智能家居、汽車電子及工業控制，專為滿足不斷變化的國內主流應用需求而設。

## 研究及開發

我們的研發能力是技術進步及業務增長的基石。在資深研發團隊的支持下，我們已在150nm至40nm主流技術節點建立自身的研發實力，並完成28nm邏輯芯片平台的開發。我們的研發工作主要著重提升技術性能、拓寬應用平台及加速新技能產業化。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無任何外部人士參與我們的研發活動。

我們於往績記錄期間一直大力投資研發。於2023年、2024年及2025年，研發開支分別為人民幣1,057.5百萬元、人民幣1,284.0百萬元及人民幣1,453.4百萬元。通過持續投資及緊貼客戶的需求，我們已於涵蓋DDIC、CIS及PIMC平台的成熟技術節點建立獨有優勢，而我們的Logic IC及MCU平台於往績記錄期間迅速增長。我們的持續研發投資及技術進步，為我們帶來可觀的知識產權組合，涵蓋半導體器件結構、製造製程、良率優化、能源效益及可靠性增強等關鍵技術領域。截至2025年12月31日，我們持有1,374項專利，其中包括1,057項發明專利；擁有354項專利申請，其中包括中國及其他司法權區的237項發明專利申請。

## 研發團隊

我們已成立穩定且經驗豐富的研發團隊，其於推進技術進步及平台發展中發揮關鍵作用。截至2025年12月31日，我們有1,976名研發人員，佔僱員總數約34.6%，其中約69.0%研發人員持有碩士或以上學位。截至2025年12月31日，核心研發團隊雲集來自國內外半導體公司的專家，彼等平均擁有逾10年相關行業經驗，於顯示驅動、圖像傳感器、電源管理及Logic IC設計及集成方面往績卓著。我們的研發工作重點圍繞技術節點及相關應用技術的開發。我們透過定向招聘及結構化內部培訓組建團隊，並輔以師友制度，使初級工程師能夠獲得實際解難及製程優化的經驗。

## 研發機制

我們已制定一套全面的研發管理體系，由清晰明確的政策及程序規管，列明參與研發過程的各部門角色、責任及工作流程。該體系使我們能夠充分提升資源效率，保持嚴格的技術標準，著重長期平台開發及商業可行性。

我們的研發流程包括4個階段：(i)項目啟動及可行性評估，我們於此階段檢討市場需求及技術可行性，以決定是否推進項目；(ii)技術開發，研發團隊於此階

## 業 務

段對所需製程技術進行開發、優化及認證，包括製程集成、器件特性分析及PDK開發工作；(iii)流片，於客戶芯片設計落實並驗證製程兼容性後進行；及(iv)工藝確證及驗證，包括性能、可靠性及質量評估，以確認製程技術符合要求的規格及標準。

### 我們的核心專利

我們亦已建立強大的專利組合，涵蓋裝置及結構創新、製程及模組技術、光刻及計算圖形化能力以及測試及計量解決方案，以保護我們的技術。截至2025年12月31日，我們絕大部分專利均為自主開發。下表載列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的部分中國註冊專利：

序號	專利名稱	專利權人	專利號	授出公告日期
1 . . . . .	一種亞分辨率輔助圖形的獲取方法	本公司	2020110697686	2023年12月5日
2 . . . . .	一種半導體結構及其製造方法	本公司	2023117225694	2024年3月1日
3 . . . . .	一種半導體結構的製作方法	本公司	2023110616998	2023年11月28日
4 . . . . .	半導體結構及其製備方法	合肥新晶	2023113026649	2023年12月26日
5 . . . . .	半導體器件及其製備方法	本公司	202410472192X	2024年6月28日
6 . . . . .	一種半導體結構及其製備方法	本公司	2023111077576	2023年11月28日
7 . . . . .	一種半導體結構的製作方法	本公司	2023114020940	2024年3月1日
8 . . . . .	一種晶圓的測試裝置及半導體機台	本公司	202322456723X	2024年5月28日
9 . . . . .	磷酸蝕刻液回收方法及蝕刻方法	本公司	202311107559X	2023年12月8日
10 . . . . .	一種圖像傳感器的製作方法	本公司	2024101293501	2024年6月4日

## 業 務

有關更多專利資料，見「附錄六—法定及一般資料—有關我們業務的進一步資料—知識產權—專利」。

### 營銷、銷售及客戶

我們已經成為客戶值得信賴的合作夥伴，於2025年，於中國大陸及中國大陸以外的國家／地區的收入分別佔總收入的61.4%及38.6%。下表載列我們於所示期間按地區劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)					
中國大陸.....	3,700,724	51.5	5,302,833	58.1	6,381,472	61.4
中國台灣.....	2,943,982	41.0	3,331,249	36.5	3,165,030	30.5
其他國家／地區 <sup>(1)</sup>	538,038	7.5	485,498	5.4	841,800	8.1
<b>合計.....</b>	<b>7,182,744</b>	<b>100.0</b>	<b>9,119,580</b>	<b>100.0</b>	<b>10,388,302</b>	<b>100.0</b>

附註：

(1) 其他國家／地區主要包括中國香港及新加坡。

我們採用直銷模式，使我們能在技術開發及製造過程中與客戶全程保持緊密合作，此亦有助於我們理解其技術需求，並提供定制晶圓代工解決方案。直接互動亦能促進及時溝通，確保項目執行的透明度。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無違反與客戶訂立的任何合同協議，以致對我們的業務運營造成重大不利影響。

我們與客戶訂立的標準晶圓代工服務協議及採購訂單的主要條款載列如下：

<b>期限</b>	協議通常為期3至5年。
<b>付款</b>	我們通常採用定期結算方式根據交付的產品開具發票並要求付款。於收到我們的發票後，客戶按照協定條款付款。
<b>物流</b>	我們一般負責將產品交付至客戶指定地點。
<b>風險轉移</b>	如需將訂購的產品交付至客戶指定地點，我們一般承擔運輸相關的成本及風險。客戶一經確認收到產品，風險即轉移至客戶。
<b>退貨安排</b>	我們承諾更換、返工或允許退回因我們過錯造成的缺陷產品。
<b>終止</b>	協議通常於雙方履行協定的各自權利及責任後終止。

## 業 務

### 我們的客戶

於往績記錄期間，我們主要為無晶圓、輕晶圓及IDM公司等集成電路設計公司提供晶圓代工服務。來自往績記錄期間各年度五大客戶的收入分別為人民幣4,618.3百萬元、人民幣5,670.7百萬元及人民幣6,018.6百萬元，佔各年度總收入的64.2%、62.2%及57.9%。來自往績記錄期間各年度最大客戶的收入分別為人民幣1,394.7百萬元、人民幣1,663.8百萬元及人民幣2,322.6百萬元，佔各年度總收入的19.4%、18.2%及22.4%。有關主要客戶相關風險，見「風險因素—有關我們業務及行業的風險—我們的成功取決於與若干主要客戶的穩固關係及開發新客戶的能力。倘我們與主要客戶的關係嚴重轉差，或未能拓闊客戶群或以其他方式有效管理與客戶相關的任何集中及交易對手方風險，均可能對我們的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響」。

下表載列我們於往績記錄期間五大客戶的身份及有關詳情：

#### 截至2023年12月31日止年度

序號	客戶	背景	所提供服務	付款安排	該客戶 應佔收入	佔總收入的 百分比	與我們 開始業務 關係的年份
					(人民幣千元)		
1.....	客戶A	一家於中國台灣成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發DDIC及SOC。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為75億台幣。	DDIC	每月結算	1,394,741	19.4%	2017年
2.....	客戶B	一家於中國北京市成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發芯片，註冊資本為人民幣431.1百萬元。	DDIC	每月結算	964,479	13.4%	2017年
3.....	客戶D	一家於中國台灣成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發顯示芯片及觸控芯片。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為45億台幣。	DDIC	每月結算	935,488	13.0%	2017年
4.....	客戶F	一家於中國深圳市成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發顯示芯片、觸控芯片及PMIC，註冊資本為人民幣52.2百萬元。	DDIC	每月結算	716,820	10.0%	2018年
5.....	客戶E	一家於中國台灣成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發顯示芯片及PMIC。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為30億台幣。	DDIC	每月結算	606,743	8.4%	2019年
					<u>4,618,271</u>	<u>64.2%</u>	

## 業 務

### 截至2024年12月31日止年度

序號	客戶	背景	所提供服務	付款安排	該客戶 應佔收入 <i>(人民幣千元)</i>	佔總收入的 百分比	與我們 開始業務 關係的年份
1.....	客戶C	一家於中國上海市成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發CIS。其於上海證券交易所上市，註冊資本為人民幣399.7百萬元。	CIS	每月結算	1,663,805	18.2%	2020年
2.....	客戶D	一家於中國台灣成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發顯示芯片及觸控芯片。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為45億台幣。	DDIC	每月結算	1,160,378	12.7%	2017年
3.....	客戶B	一家於中國北京市成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發芯片，註冊資本為人民幣431.1百萬元。	DDIC	每月結算	1,081,862	11.9%	2017年
4.....	客戶A	一家於中國台灣成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發DDIC及SOC。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為75億台幣。	DDIC	每月結算	1,046,565	11.5%	2017年
5.....	客戶F	一家於中國深圳市成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發顯示芯片、觸控芯片及PMIC，註冊資本為人民幣52.2百萬元。	DDIC	每月結算	718,068	7.9%	2018年
					5,670,678	62.2%	

## 業 務

### 截至2025年12月31日止年度

序號	客戶	背景	所提供服務	付款安排	該客戶 應佔收入	佔總收入的 百分比	與我們 開始業務 關係的年份
					(人民幣千元)		
1.....	客戶C	一家於中國上海市成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發CIS。其於上海證券交易所上市，註冊資本為人民幣399.7百萬元。	CIS	每月結算	2,322,640	22.4%	2020年
2.....	客戶A	一家於中國台灣成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發DDIC及SOC。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為75億台幣。	DDIC	每月結算	1,081,062	10.4%	2017年
3.....	客戶B	一家於中國北京市成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發芯片，註冊資本為人民幣431.1百萬元。	DDIC	每月結算	1,026,696	9.9%	2017年
4.....	客戶G	一家於中國台灣成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發小尺寸DDIC。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為15億台幣。	DDIC	每月結算	794,648	7.6%	2021年
5.....	客戶D	一家於中國台灣成立的無晶圓公司，主要從事設計及開發顯示芯片及觸控芯片。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為45億台幣。	DDIC	每月結算	793,532	7.6%	2017年
					<u>6,018,578</u>	<u>57.9%</u>	

截至最後實際可行日期，董事、其緊密聯繫人或任何股東(擁有或據董事所知擁有我們已發行股本5%以上)概無於往績記錄期間各年度的任何五大客戶中擁有任何權益。我們於往績記錄期間各年度的五大客戶均為獨立第三方。

### 客戶集中度

於2023年、2024年及2025年，來自往績記錄期間各年度五大客戶的收入分別為人民幣4,618.3百萬元、人民幣5,670.7百萬元及人民幣6,018.6百萬元，佔各年度總收入的64.2%、62.2%及57.9%。於2023年、2024年及2025年，來自往績記錄期間各年度最大客戶的收入分別為人民幣1,394.7百萬元、人民幣1,663.8百萬元及人民幣2,322.6百萬元，佔各年度總收入的19.4%、18.2%及22.4%。此集中情況與全球晶圓代工行業結構一致，由於具備龐大產量且對代工供應商有嚴格認證要求的領先集成電路設計公司數量有限，該行業天然具有客戶高度集中的特徵。我們的關鍵客戶為顯示驅動、圖像傳感器及電源管理領域的公認行業領導者，其穩定的需求及長期採購安排為我們的收入基礎作出重大貢獻。此集中度進一步體現長期的相互支持，即客戶依賴我們的技術平台及穩定產出，而我們則保持緊密協作與持續供應，從而維持持久的合作夥伴關係。

## 業 務

於往績記錄期間，我們錄得最大及前五大客戶應佔收入出現若干波動。有關波動主要受全球半導體行業週期性、客戶根據終端市場需求變化進行存貨調整，以及消費電子等下游市場競爭動態所帶動。該等波動亦反映我們業務的自然進程，包括CIS產品進入量產，以及深化與關鍵客戶的合作，導致不同報告期內訂單量的變化。

我們明白依賴少數客戶使我們面臨潛在風險，例如客戶策略重心或市況變化導致訂單減少、定價壓力或流失關鍵客戶。為減輕該等風險，我們正推行客戶及產品多元化策略。具體而言，我們通過與汽車電子、工業控制及微顯示等高增長領域的新客戶合作以擴大客戶群；擴充及豐富我們的技術平台，以提高CIS及其他先進產品的佔比；以及將產品應用延伸至基於55/40nm、28nm及其他先進製程節點的新興場景。我們同時正在提升生產靈活性及項目管理能力，以高效應對市場波動，確保及時的產能分配及運營韌性。

根據弗若斯特沙利文的資料，高客戶集中度為半導體代工行業常態，由於所需的高技術認證要求、產能承諾及長期協作，全球頂級客戶通常佔代工企業收入的重大部分。根據同一資料來源，我們於往績記錄期間的客戶集中度水平符合行業慣例，反映領先代工企業與全球主要集成電路設計公司之間的標準商業安排。

### 營 銷

我們致力與不同應用領域的領先公司建立長期深入的合作關係，這將支持業務往來及增強客戶粘性。為此，我們設有架構完善的銷售團隊，採取靈活的營銷策略，整合多種渠道及計劃，擴大及豐富我們的客戶群。

我們的策略依賴市場分析來識別潛在客戶，並為其匹配合適的技術平台。我們與上下游行業參與者保持溝通，並參與行業協會以拓展客戶聯繫。我們透過定期拜訪客戶跟進不斷變化的產品需求及加強合作。我們亦通過參與學術及行業活動以及於網站及媒體渠道展示技術，以建立知名度。該等活動有助於我們接觸更廣泛的客戶群，並維持穩定、長期的業務關係。

### 客 戶 服 務

我們的銷售及營銷團隊為客戶提供從產品開發及解決方案優化到售後支持的綜合服務，旨在鞏固長期關係以及提高客戶的忠誠度。我們定期通過電話、電郵及日常拜訪收集客戶回饋。收到客戶提出的任何質量相關投訴後，我們的技術團隊迅速進行根本原因分析。倘經內部調查確認存在產品缺陷，我們的質量控制部將立即啟動補貨或更換程序。我們的實驗室提供電性及物性失效分析，並向客戶提供改進報告以供聯合檢討。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無發生任何產品質量事件或客戶因質量問題要求任何退貨或返工而對我們的經營業績造成重大不利影響。

## 業 務

### 定價

我們的產品定價考慮多項因素，包括市場供需、生產成本、產品規格、產品的技術複雜程度及現行市價。我們致力於提供具競爭力的定價，同時確保我們業務的可持續發展及盈利能力。

### 我們的採購

晶圓代工依賴優質原材料及設備。於往績記錄期間，我們主要從東亞、歐洲、北美、中國大陸及中國台灣採購生產級硅晶圓、化學品、氣體、濺射靶材、光刻膠及零配件等原材料及用於晶圓代工的設備。

我們已建立內部機制以維持原材料及設備的質量穩定性及供應持續性。我們僅向通過資質審查、效率檢驗及實地評估的供應商進行採購，評估基準包括技術能力、產品質量、資質、聲譽及定價。為增強供應鏈穩定性，我們分散供應商群體，並優先整合國內供應商。我們亦持續評估質量、定價及服務，以維持閉環採購管理流程。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們一般維持從多名供應商採購關鍵原材料及製造設備，以免過度依賴任何單一來源。

為緩解原材料成本上漲的潛在影響，我們與若干關鍵原材料供應商訂立長期協議。我們亦因應市場定價波動與供應商建立靈活的定價機制，並落實定期檢討，通過考慮存貨水平、銷售前景及市場趨勢監控成本。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遭遇任何重大供應短缺、質量問題、與供應商供應有關的中斷、糾紛或延誤，或與供應商的合同安排出現任何重大違約。

下表概述我們與原材料供應商的典型協議及採購訂單的主要條款：

<b>期限</b>	協議期限通常介乎2至3年。
<b>付款</b>	付款通常在協定信用期內收取後作出。
<b>物流及風險轉移</b>	交付及運輸風險一般參考國際貿易常用條款，並根據我們與供應商之間의 共同協議分擔。
<b>退貨安排</b>	我們通常要求供應商退還或更換不符合我們質量要求的產品。相應費用由供應商承擔。
<b>終止</b>	協議通常於協定期限屆滿或於雙方履行協定權利及責任後終止。

## 業 務

下表概述我們與設備供應商的典型協議及採購訂單的主要條款：

<b>期限</b>	協議通常為期1年。
<b>付款</b>	付款通常在協定信用期內收取。
<b>物流及風險轉移</b>	我們的設備供應商一般須將設備交付至指定地點。於交付設備後，風險轉移至我們。
<b>質量擔保</b>	供應商須於協議訂明的指定保證期內提供質量保證及服務。
<b>終止</b>	協議通常於雙方履行協定權利及責任後終止。

### 我們的供應商

我們的供應商主要包括原材料及設備供應商。向往績記錄期間各年度五大供應商的採購額分別為人民幣1,395.3百萬元、人民幣1,528.6百萬元及人民幣1,864.8百萬元，佔相應年度採購總額的39.9%、34.9%及35.1%。向往績記錄期間各年度最大供應商的採購額分別為人民幣591.1百萬元、人民幣512.4百萬元及人民幣580.8百萬元，佔相應年度採購總額的16.9%、11.7%及10.9%。有關主要供應商相關風險，見「風險因素—有關我們業務及行業的風險—我們的營運倚賴若干主要供應商適時以合理價格供應主要原材料及設備。供應鏈的任何中斷(包括短缺、延誤或成本上升)均可能對我們的生產及財務業績造成不利影響」。

## 業 務

下表載列於往績記錄期間五大供應商的身份及相關詳情：

**截至2023年12月31日止年度**

序號	供應商	背景	向我們提供的 產品/服務	付款安排	採購額 <i>(人民幣千元)</i>	佔採購總額 的百分比	與我們 開始業務 關係的年份
1.....	供應商A	一家於中國台灣成立的公司，主要從事製造及供應半導體晶圓。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為100億台幣。	退火晶圓及 外延晶圓	開具發票後 45天內電匯	591,147	16.9%	2016年
2.....	供應商B	一家於中國安徽省成立的國有公司，主要從事供電。	電力公共事業	每月通過電匯 結算	406,714	11.6%	2018年
3.....	供應商C	一家於1995年在新加坡註冊成立的公司，主要從事提供半導體材料。	半導體製程 設備及組件	於裝運及最終驗 收等里程碑結 合採用電匯及 信用證	157,950	4.5%	2017年
4.....	供應商F	一家於中國廣東省成立的公司，主要從事供應工業氣體。其於上海證券交易所上市，註冊資本為人民幣13億元。	氮氣、氧氣及 氫氣等工業 氣體	開具發票後 30天內電匯	120,890	3.5%	2020年
5.....	供應商G <sup>(1)</sup>	一家於美國成立的公司，主要從事提供特種化學品等基於技術的製造必需品。其於紐約證券交易所上市。	拋光液、清洗劑 及光刻膠	開具發票後 30或60天內 電匯	118,570	3.4%	2016年
					<b>1,395,271</b>	<b>39.9%</b>	

附註：

(1) 註冊資本不適用。

## 業 務

### 截至2024年12月31日止年度

序號	供應商	背景	向我們提供的 產品/服務	付款安排	採購額  (人民幣千元)	佔採購總額 的百分比	與我們 開始業務 關係的年份
1.....	供應商B	一家於中國安徽省成立的國有公司，主要從事供電。	電力公共事業	每月通過電匯 結算	512,421	11.7%	2018年
2.....	供應商A	一家於中國台灣成立的公司，主要從事製造及供應半導體晶圓。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為100億台幣。	退火晶圓及 外延晶圓	開具發票後 45天內電匯	404,251	9.2%	2016年
3.....	供應商C	一家於1995年在新加坡註冊成立的公司，主要從事提供半導體材料。	半導體製程 設備及組件	於裝運及最終驗 收等里程碑結 合採用電匯及 信用證	223,219	5.1%	2017年
4.....	供應商D	一家於中國江蘇省成立的公司，主要從事製造半導體晶圓，註冊資本為人民幣50億元。	外延晶圓及 拋光晶圓	每月核實後 60天內電匯	209,347	4.8%	2020年
5.....	供應商G	一家於美國成立的公司，主要從事提供特種化學品等基於技術的製造必需品。其於紐約證券交易所上市。	拋光液、清洗劑 及光刻膠	開具發票後 30或60天內 電匯	179,397	4.1%	2016年
					<b>1,528,635</b>	<b>34.9%</b>	

## 業 務

### 截至2025年12月31日止年度

序號	供應商	背景	向我們提供的產品/服務	付款安排	採購額	佔採購總額的百分比	與我們開始業務關係的年份
					(人民幣千元)		
1.....	供應商B	一家於中國安徽省成立的國有公司，主要從事供電。	電力公共事業	每月通過電匯結算	580,820	10.9%	2018年
2.....	供應商A	一家於中國台灣成立的公司，主要從事製造及供應半導體晶圓。其於臺灣證券交易所上市，註冊資本為100億台幣。	退火晶圓及外延晶圓	開具發票後45天內電匯	526,086	9.9%	2016年
3.....	供應商C	一家於1995年在新加坡註冊成立的公司，主要從事提供半導體材料。	半導體製程設備及組件	於裝運及最終驗收等里程碑結合採用電匯及信用證	324,494	6.1%	2017年
4.....	供應商D	一家於中國江蘇省成立的公司，主要從事製造半導體晶圓，註冊資本為人民幣50億元。	外延晶圓及拋光晶圓	每月核實後60天內電匯	226,679	4.3%	2020年
5.....	供應商G	一家於美國成立的公司，主要從事提供特種化學品等基於技術的製造必需品。其於紐約證券交易所上市。	拋光液、清洗劑及光刻膠	開具發票後30或60天內電匯	206,684	3.9%	2016年
					<u>1,864,763</u>	<u>35.1%</u>	

截至最後實際可行日期，概無董事、其緊密聯繫人或任何股東(擁有或據董事所知擁有我們已發行股本5%以上者)於往績記錄期間各年度的任何五大供應商中擁有任何權益。我們於往績記錄期間各年度的五大供應商均為獨立第三方。

### 存貨管理、倉庫及物流

我們的存貨主要包括原材料、在製品及製成品。截至2023年、2024年及2025年12月31日，存貨分別為人民幣1,492.7百萬元、人民幣1,503.3百萬元及人民幣1,714.9百萬元。我們根據生產需求、產品複雜性及其他外部因素動態管理製成品、在製品及原材料的存貨水平，並在必要時調整儲備存貨，以確保供應連續性。通過將財務數據納入生產計劃，我們的方法提升資本利用率及支持有效風險控制。於往績記錄期間直至最後實際可行日期，我們並無遭遇任何原材料嚴重短缺或陳舊的情況。

截至2025年12月31日，我們於中國安徽省有3間倉庫。我們的倉庫根據材料的特性對溫度及濕度等環境條件進行嚴格控制，以確保產品的安全及質量。我們定期優化流程及培訓員工，以支持高效的生產及供應鏈運作。

## 業 務

就物流而言，我們與第三方服務提供商合作，選擇第三方服務提供商的原因為其能夠滿足我們在專業處理、安全包裝和按時交付方面的要求。我們已建立風險管理規程，以解決損壞或延誤等潛在問題，並與物流合作夥伴密切合作，確保我們的產品安全可靠地交付予客戶。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在產品交付方面並無經歷任何重大中斷，亦未因物流服務提供商延遲交付或不當處理產品而遭受任何重大損失。

### 第三方付款

#### 背景

於往績記錄期間，我們的少數客戶（「**相關客戶**」）通過第三方付款人（「**第三方付款人**」）向我們結算款項，而我們的客戶、第三方付款人與本集團於第三方付款人付款前已訂立三方協議同意該等安排作為預防措施的一環（「**第三方付款安排**」）。考慮到三方協議架構在相關各方當中確立清晰的付款責任、證明文件及付款指示，我們認為第三方付款安排實現相對較低的風險，與非正式付款安排相比，大大減少交易對手及收款風險。出現該等安排主要由於若干客戶(i)缺少所需的進口或外匯結算資質及(ii)就付款流程使用聯屬交易實體。於2023年、2024年及2025年，相關客戶的數目分別為2名、3名及5名，而於各相同期間第三方付款人的數目為1名、2名及4名。於2023年、2024年及2025年，所收取的第三方付款（「**第三方付款**」）總額分別為人民幣1.4百萬元、人民幣11.8百萬元及人民幣11.7百萬元，分別佔各相同期間總收入的0.02%、0.13%及0.11%。於往績記錄期間，並無個別相關客戶對我們的收入作出重大貢獻。據董事所深知，概無相關客戶或彼等各自的第三方付款人過往或現時與我們、我們的附屬公司、股東、董事或高級管理層或彼等各自的任何聯繫人存在任何關係（不論業務、僱傭、家族、信託、資金流、融資或其他關係）。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無收到來自第三方付款人或其清盤人的任何申索。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，除接受第三方付款安排項下的付款外，我們並無主動開始任何第三方付款安排，亦無參與任何其他形式的有關安排。此外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無為促進或鼓勵第三方付款安排而向任何相關客戶或第三方付款人提供任何折扣、佣金、返利或其他利益。相關客戶的支付、定價條款及其他一般商業條款與我們的其他客戶大致相同。據我們的中國法律顧問告知，第三方付款安排並無違反任何中國法律及法規的禁止性規定。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，經董事確認，(i)我們並無與任何相關客戶或第三方付款人產生任何糾紛，亦無收到其任何退款要求；及(ii)我們並無就第三方付款安排涉及任何糾紛或被有關政府機關施加行政處罰。

董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，(i)所有第三方付款均與我們及相關客戶之間的真實交易有關，並通過銀行轉賬進行；(ii)我們向第三方付款人收取的第三方付款金額與相關客戶與我們之間的相關銷售訂單、記錄及／或發票中的交易金額一致；(iii)涉及第三方付款的所有相關交易均已完成，

## 業 務

並按照各協議中訂明的協定金額結算；(iv)我們並無遇到任何要求我們退還相關交易付款的事件；及(v)我們並無注意到任何會導致董事懷疑相關交易真實性或所涉相關人士誠信的情況。基於上文所述，董事相信及中國法律顧問告知，第三方付款人可能要求退還資金的風險較低。

### 第三方付款安排的內部控制措施

為保障我們免受與第三方付款安排有關的風險，我們已加強內部控制措施，包括：(i)對相關客戶進行有效評估，從而防止欺詐或洗錢活動，確保交易完整性。我們對第三方付款人的資格進行嚴格篩查，以確保其身份真實性；及(ii)告知僱員有關第三方付款安排的風險及經加強的內部控制措施，要求全體僱員拒絕或退還任何不符合上述程序的有關安排付款。我們計劃於[編纂]前終止第三方付款安排，並於未來禁止第三方付款安排。具體而言，我們已要求相關客戶取得必要的進出口或外匯結算資格及直接向我們付款。倘任何相關客戶不願取得該等證書，我們將停止與其交易。

考慮到來自第三方付款安排的收入佔總收入的比例並不重大，董事確認，第三方付款安排不會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生任何重大不利影響。

### 質量控制

我們嚴格遵守《中國產品質量法》。我們已建立全面的質量管理系統，並制定《品質手冊》。我們根據ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000及IATF16949要求的標準獲得認證。我們的產品經過嚴格測試及驗證，確保產品符合行業標準及客戶要求。截至2025年12月31日，267名僱員負責質量控制、監督系統審核、供應商管理、產品分析及持續改進。

我們的質量控制流程涵蓋技術開發、採購、生產、儲存及交付。我們透過結構化規劃控制偏差、檢驗進料、管理供應商質量及進行內部審核，以確保工作流程一致及培訓合規。在生產過程中，我們運用統計方法監控製程趨勢、識別異常情況並實施糾正措施，而工程變更則通過分階段驗證及可靠性檢測進行管理。我們記錄及處理工廠問題、維持環境穩定性，並在整個開發及量產過程中注重產品可靠性。我們亦檢討客戶反饋，並在量產中與客戶合作設定良率及缺陷識別要求，共同分析測試數據以推動持續改進。

### 知識產權

我們依據我們運營所在司法權區的專利、商標、版權及其他知識產權保護法律，結合公平交易常規、合同安排及保密程序建立及保護我們的專有技術。截至2025年12月31日，我們持有1,374項專利，其中包括1,057項發明專利；擁有354項專利申請，其中包括中國及其他司法權區的237項發明專利申請。見「附錄六一法定及一般資料」。

我們已建立全面的知識產權保護框架，涵蓋專利、集成電路佈圖設計、商業秘密、商標、軟件權利及保密知識，並由專門的法律、研發及信息安全團隊提供支持。

## 業 務

在專利管理方面，我們運作一個涵蓋專利挖掘、評估、備案、申請、審查意見處理及維護的系統，並制定明確的程序用於發明人提交及專利性審查。更適合以保密方式保護的技術則遵循我們的商業秘密及專有知識制度，該制度規範將若干專利提案轉為商業秘密保護的程序。我們已制定內部規章，明確規定僱員的保密職責、知識產權所有權及未經授權使用的限制。商標流程涵蓋檢索、註冊、使用、重續及監控，而版權合規則規範授權材料的使用。集成電路布圖設計及軟件開發遵循文件記錄、註冊、權利所有權及保密要求。公司層面的知識產權合規界定責任、監督及審計，並通過結構化程序指導內部審查、證據收集、法律評估及針對潛在侵權事件的應對措施。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的知識產權並無受到任何嚴重侵犯或被第三方指控侵犯。

### 數據安全及隱私

在運營過程中，我們主要收集、儲存及處理來自企業客戶的交易相關資料，包括姓名／名稱、地址、聯絡信息及訂單詳情。我們確保數據安全及隱私的措施包括防火牆及入侵防禦系統等技術、嚴格的訪問控制、數據處理內部協定、數據備份系統以及數據保護的詳細程序。於往績記錄期間，我們並無從事跨境數據交易，亦未被歸類為《網絡安全審查辦法》下掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者或關鍵信息基礎設施運營者。

據中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已在所有重大方面遵守適用數據安全法律及法規。見「風險因素—有關我們業務及行業的風險—未能或被認為未能遵守資料隱私及安全法，或對我們在收集、使用、存儲、保留、轉移、披露及其他資料處理方面的慣例或政策的其他顧慮，均可能使我們面臨潛在責任」。

### 競爭

晶圓代工行業的競爭格局以高度集中及動態創新為特點，領先的全球及國內晶圓代工企業持續投資製程技術及產能擴張。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，2025年全球十大晶圓代工企業合共佔96.9%的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，2025年我們為全球第九大晶圓代工企業及中國大陸第三大晶圓代工企業。根據同一資料來源，2020年至2025年期間，全球前十大晶圓代工企業中，我們的產能和營收增長速度為全球第一。我們在技術創新、製程優化、客戶參與及產能擴張方面的持續投資將使我們借助新興市場趨勢進一步鞏固我們在全球晶圓代工市場的領先地位。見「行業概覽」。

## 業 務

### 僱員

截至2025年12月31日，我們在中國大陸及日本有5,710名全職僱員。下表載列截至同日按業務職能劃分的僱員明細：

業務職能	僱員人數	百分比 (%)
生產 .....	3,133	54.9
研發 .....	1,976	34.6
行政 .....	491	8.6
銷售及營銷 .....	110	1.9
<b>合計 .....</b>	<b>5,710</b>	<b>100.0</b>

我們的招聘策略涵蓋校園招聘、線上平台及外部招聘機構以及內部推薦及調任。我們提供績效獎金以激勵和獎勵全職僱員，並已建立培訓體系，以打造互相支持的工作環境。為正式確立僱傭關係，我們與所有全職僱員訂立標準勞動合同及保密協議。對於主要研發人員，我們亦於僱傭協議中納入不競爭條款保障我們的商業利益。我們已成立工會，以促進僱員之間的溝通及保障其權利。我們相信，我們與僱員之間保持良好的工作關係，且於往績記錄期間及直至最後實際可行日期並無遇到任何重大勞資糾紛，在招聘員工方面亦無任何困難。

### 物業

我們的總部位於安徽省合肥市。截至最後實際可行日期，我們並無賬面值佔總資產15%或以上的任何單一物業。根據香港上市規則第五章及公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第6(2)條，本文件獲豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例第342(1)(b)條的規定，毋須根據公司(清盤及雜項條文)條例附表3第34(2)段所述將所有土地或樓宇的權益納入估值報告。

### 自有物業

我們在中國擁有及佔用若干地塊及樓宇用於業務運營。該等物業用作上市規則第5.01(2)條所界定的非物業業務。截至最後實際可行日期，我們於中國有權使用1幅地塊及擁有24項物業，總建築面積約為623,181.5平方米，主要用作生產設施及辦公室用途。於2024年3月，我們與關連人士合肥藍科投資有限公司訂立土地轉讓協議，以建設新生產廠房用於製造改進技術平台，使我們能夠擴充產能及適時滿足市場需求。在此安排中，我們購入土地使用權及該土地上的在建項目(包括廠房建築物、構築物及生產廠房)，總地盤面積約為140,235.8平方米，而合肥藍科投資有限公司應按要求完成建設工程。截至最後實際可行日期，我們已就所有自有物業取得土地使用權證。

## 業 務

### 租賃物業

截至最後實際可行日期，我們於中國租賃4項物業，總建築面積約為36,742.7平方米，主要用作員工宿舍及辦公室。該等租賃的期限一般介乎1至2年。截至最後實際可行日期，我們已向中國相關土地及房地產管理部門辦理所有租賃物業的租賃協議登記及備案。

### 保險

我們為日常運營投保。我們的主要保單主要包括僱員相關保險、財產一切險及營業中斷險，我們相信該等保單已涵蓋我們運營所在司法權區內日常運營的主要風險。根據一般市場慣例，我們並無投購於我們運營所在司法權區無法取得或法律一般並無規定的若干保單。見「風險因素—有關我們業務及行業的風險—我們可能並無足夠的保險以覆蓋我們的業務風險」。

我們相信，我們的保險覆蓋範圍足以應付我們的業務，且符合一般市場慣例。我們將繼續檢討及評估我們的風險組合，並對我們的保險計劃作出必要及適當的調整，以配合我們的需要及行業慣例。於往績記錄期間，我們並無就業務提出任何重大保險申索。

### 環境、社會及企業管治

我們致力於可持續發展，通過將環境、社會與管治（「ESG」）原則融入日常經營之中，不斷提升ESG表現。我們爭取做好環境保護與節能減碳，維護安全健康職場，善盡企業公民責任。

### ESG治理

#### ESG管治架構

我們的董事會對ESG事宜負有整體責任，深知其對企業發展的重要性，為此設立戰略與ESG委員會並制定《戰略與ESG委員會工作規則》，委派該委員會負責審議發展戰略、研究ESG相關事項並向董事會提出建議，每年召開會議審定ESG議題。

我們亦設立ESG推行委員會，向戰略與ESG委員會匯報，ESG推行委員會負責整合及統籌本公司ESG執行工作。ESG推行委員會下設3個工作分組，分別推動各部門在環保節能減碳、履行社會責任、提升公司管治方面開展工作，由相關部門主管擔任各組組長。在往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已於所有重大方面遵守所有適用ESG法律法規。

#### 重要議題風險識別

我們從財務和影響重要性兩個維度出發，識別及評估ESG議題對本公司商業模式、運營、戰略等核心可持續發展領域的影響。相關業務部門與各持份者溝通，傳達持份者的關注事項和期望，為我們識別重要議題提供參考。我們引入短期、中期和長期的時間維度，對不同時間段的財務影響進行加權評分。

## 業 務

我們的關鍵ESG風險及相應緩解措施主要包括：i)因大舉投資及商業化延遲導致的長期研發風險，應對措施為產品線多元化、優化研發流程及加強客戶合作；ii)供應商的環境及社會問題帶來的中期供應鏈風險，緩解措施為嚴格的供應商篩選、ESG監控、審計及培訓；iii)短期產品質量風險，可藉由嚴格的質量控制、測試及反饋機制降低；iv)關鍵人員流失帶來的長期員工管理風險，緩解措施為激勵計劃、培訓、保密管理及技術團隊多元化；及(v)與污染及有害廢棄物有關的短期環境合規風險，應對措施為優化生產流程、提升效率及加強循環利用、排放監測、購買綠電，以及加強培訓及應急演練。

### 環境保護

#### 原材料管理

我們重視原材料及生產的環境可持續性，持有QC080000認證，並執行無有害物質(「HSF」)政策，以確保符合國際及本地法規，於往績記錄期間，我們的產品HSF合格率高達100%。我們建立多項有害物質管制制度，明確責任、檢測要求及供應商門檻，涵蓋所有相關原材料、產品、設備及包裝，並透過定期檢驗持續完善化學品管理。我們亦每半年對原材料供應商進行考核，重點關注品質、綠色認證及ESG表現，以推動績效改善。

於往績記錄期間，概無發生因化學品管理不當造成的事故及人身傷害。就涉及有害物質的供應商而言，《不使用有害物質承諾書》或同等效力文件簽署比例達100%。於2025年，我們合共對229種原材料進行有害物質監測及管理，全部符合規定標準。

#### 能源管理

我們優先考慮節能減排及資源可持續使用，並已建立基於ISO50001的能源管理體系，以強化監測並優化能源使用，認證於2025年完成。我們推動全公司參與節能行動，並設定目標，於2030年前降低單位產品的能耗強度，保持能源消耗總量年增長率低於行業平均水平。

#### 水資源管理

我們通過優化生產工藝流程、加強用水管理，減少生產過程中的水資源消耗。我們注重水資源循環利用，通過建立廠內回收水機制，收集回收符合廠內標準的生產製程排水，將其再次用於次級用水環節，實現水資源最大化利用。於2025年，我們的用水密度為0.00607立方米／平方厘米晶圓面積。我們分析了10家營收規模全球領先的晶圓代工企業，其中5家披露可資比較用水密度數據，介乎0.007至0.00982立方米／平方厘米晶圓面積。經比較，我們的表現處於領先水平。我們也鼓勵員工在日常工作中積極參與，共同推動節水。

## 業 務

### 循環經濟

我們通過引入生產工藝與設備、推行清潔生產模式、建立規範回收體系，踐行循環經濟原則。我們優先選用可循環包裝材料，並回收複用出貨紙箱。2025年，我們的製程排水回收再利用率達到78%，回收再利用出貨紙箱量超過78,047個。通過輕量化設計，每套出貨緩衝材減重0.3 kg，2022年至2025年減少用量71噸。2025年至2030年，我們計劃維持每年75%或以上的廢棄物回收及再利用率。

下表列載我們在往績記錄期間的能源、資源消耗情況。因2025年逐步擴充產能，消耗總量和密度均有所上升。

類別	單位	2023年	2024年	2025年
綜合能源消耗量.....	噸標煤	76,099	73,671	114,715
綜合能耗強度.....	噸標煤/片	0.079	0.055	0.069
總耗水量.....	噸	790,611	1,800,277	1,104,684
用水密度.....	立方米/平方 厘米晶圓面積	0.00650	0.00626	0.00607
循環用水量.....	噸	2,649,575	3,047,015	6,777,458
廢棄物資源化再利用率...	%	75.1	77.8	80.56

### 污染排放與廢棄物

我們嚴格遵循相關法律法規，持續完善內部環境管理體系，對廢氣、廢水、固體廢棄物進行管控。

我們通過密閉式管線、無塵車間及自動化設備減少揮發，並安裝高效處理設施，確保排放達標且低於限值；污水處理站使用分質分類系統，總排口設在線監測並結合手工取樣分析，2024年千片產品廢水中主要污染物排放量較2023年下降，排放濃度遠低於法定限值；固體廢物建立台賬，委託有資質第三方處置或再利用，並每年定期現場稽核。

下表列載我們在往績記錄期間產生的廢水、廢氣與廢棄物明細。於2025年，因逐步擴充產能，總量和密度均有所上升。

類別	單位	2023年	2024年	2025年
工業廢水總量.....	立方米	3,619,806	4,162,734	5,967,496
廢水排放密度.....	立方米/百萬 人民幣收入	504.0	456.5	574.4
廢氣總量.....	立方米	10,419,724,350	10,641,345,780	18,160,049,160
廢氣排放密度.....	立方米/百萬 人民幣收入	1,450,660.7	1,166,868.0	1,748,124.9
廢棄物總量.....	噸	13,321.0	14,085.0	22,611.9
廢棄物排放密度.....	噸/百萬 人民幣收入	1.9	1.5	2.2
一般工業固廢生成總量.....	噸	7,439.0	8,025.0	12,082.8
危險(有害)廢物生成總量....	噸	5,882.0	6,060.0	10,529.1

## 業 務

### 氣候風險識別與管理

我們已建立系統以評估氣候變化對運營、供應鏈及市場構成的風險，並制定相應的應對措施和應急方案。我們亦設立碳管理委員會，負責推動節能降耗、設定年度減排目標，並每年開展碳排放量核查。

我們面臨轉型與實體風險，包括合規與運營成本上升、供應商產能下降、極端天氣與長期氣溫上升對效率及生產造成影響。我們透過逃生演習、預防機制、準備應急能源及水供應應對該等風險，並輔以基於ISO的環境、安全及健康（「ESH」）管理、環保技術、提升循環利用率及供應商ESG稽核。我們亦識別氣候相關機遇，例如效率提升、成本降低、產品需求增加、市場拓展、韌性增強，以及採納節能技術及新能源汽車芯片，並進一步加強環境披露以及強化氣候風險及機遇管理。

### 氣候指標及目標

基於ISO14064-1:2018，我們定期開展年度溫室氣體排放盤查工作，並取得第三方核查聲明書。我們亦重視碳排放管理。於2025年，我們的碳排放密度為0.00065噸二氧化碳當量／平方厘米晶圓面積。於十大晶圓代工企業中，5家披露了可資比較數據，碳排放密度介乎0.00038至0.00137噸二氧化碳當量／平方厘米晶圓面積。經比較，我們處於中間水平。下表列載於往績記錄期間範圍1及範圍2的排放。

排放類別	截至12月31日止年度		
	2023年 (tCO <sub>2</sub> )	2024年 (tCO <sub>2</sub> )	2025年 (tCO <sub>2</sub> )
範圍1—直接溫室氣體排放.....	134,831.3	202,969.9	238,238.34
範圍2—輸入能源的間接溫室 氣體排放.....	333,452.5	507,649.6	513,851.73
合計.....	<b>468,283.8</b>	<b>710,619.5</b>	<b>767,872.45</b>

我們高度重視生產全流程的節能減排與資源可持續利用。我們已明確減碳路徑，並制定《碳管理辦法》，採取涵蓋排放、資產、減排及盤查的多項措施，識別高耗能、高排放的流程。

2025年度，我們共開展了39項節能減碳專案工作，涵蓋節電、廢水減量、空調節能調整等領域，實現累計節能約354萬kWh。我們進一步推動能源結構綠色轉型，提升清潔能源使用佔比，截至2025年12月31日，採購綠色電力27,240 MWh，減少二氧化碳排放量17,849噸，並計劃未來購買碳權。我們致力於到2030年實現碳達峰，到2060年實現碳中和。2025年至2030年間，我們計劃每年將碳排放密度(每片晶圓產品的二氧化碳排放量)降低2%。以2025年為基準年，我們亦將在2030年之前每年增加1%的可再生能源(綠色電力)年採購量。

## 業 務

### 社會責任

#### 員工僱傭與發展

我們優先考慮僱員權利，營造公平、共融且無歧視的職場。我們嚴格遵守相關法律及法規，已制定管理標準及政策，明確公平的招聘、標準僱傭管理、工作時間、薪資及福利、保險及女性員工保護，確保僱傭合法合規，保障平等發展機會。我們通過人才發展計劃支持員工職業發展，並依據《員工績效考核辦法》及《年度晉升作業施行細則》執行年度績效和晉升考核。我們亦透過內部培訓、在線學習平台及外部訓練為員工提供訓練及發展計劃。

我們設福利關懷課專職崗，收集員工需求，完善制度。2024年我們開通線上心理諮詢平台，保障員工心理健康。

員工構成	單位	截至12月31日		
		2023年	2024年	2025年
員工總數 .....	人	4,594	5,348	5,710
按性別				
男性佔比 .....	%	73.6	73.6	73.6
女性佔比 .....	%	26.4	26.4	26.4
按年齡				
31歲以下佔比 .....	%	62.8	60.9	58.0
31-50歲佔比 .....	%	34.9	37.0	40.1
50歲以上佔比 .....	%	2.3	2.1	1.9

#### 職業健康與安全

我們已設立安全生產管理委員會，定期召開ESH會議並進行體系審查，以確保依據ISO140001及ISO45001穩定運作及保障廠區安全。我們已採納相關規則及法規，定期開展安全培訓及逃生演習，打造ESH監控平台，並運用智能工具進行日常巡查以識別隱患。我們致力於打造健康安全的職場，設立健康管理中心提供定期體檢及監測職業風險，並實施相關措施保障員工身心健康。在往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未發生任何重大傷亡或員工因工死亡的重大事件。

#### 供應鏈管理

為打造可持續供應鏈，我們已制定《供應商管理辦法》及《承攬商評鑑與管理細則》等規定並開發SRM系統，智能管控供應鏈，保障品質並推動供應商ESG績效提升。

我們定期對現有供應商進行稽核，重點關注環境及安全合規，於2024年及2025年，我們分別完成82家及176家供應商稽核，所有供應商均通過稽核且未發現重大違規。於2025年，我們舉辦了13場ESG供應鏈協作專場培訓，分享安全應急管理經驗，協助供應商提升ESG管理能力。共57家供應商參與培訓。新供應商須接受信用、認證及測試評估，而我們僅委聘合資格供應商。供應商須簽署道德及有害物質承諾書，遵守相關ISO標準，並接受定期ESG綜合績效評估。

## 業 務

### 公益活動

我們以實現社會共贏為目標，積極助力教育扶持、扶貧助困等社會民生計劃。我們組織參與「童芯助學」、「衣舊愛」、「晶芯築愛 守護童芯」、「芯連星」等助學及科普活動，開展植樹、空瓶回收等環保公益活動，以實際舉措傳遞企業社會責任溫度。2025年，我們的志願活動參與人次達3,438人次，志願活動時長達2,888小時。

### 企業管治

#### 董事會多元化與專業化

我們的董事會認識到良好的ESG績效對企業發展和股東回報的重要性，並積極推動董事會的多元化。有關董事會組成的詳情，見「董事及高級管理層」。

我們已採納規範董事、高級管理層及員工的行為準則及敬業規範，並設立敬業促進委員會負責監督道德合規。董事承諾不會不當使用內幕消息，而員工則須遵循誠信原則，並定期接受反貪污培訓。我們亦已設立舉報及調查機制，由稽核室調查員工或外部人士透過多種渠道提交的舉報，並設有嚴格的保密保護措施。

### 行業週期性

我們的經營業績受半導體行業週期性的影響。見「行業概覽—全球晶圓代工市場—全球晶圓代工市場規模」。鑒於當時的市場狀況，於往績記錄期間，我們的業務持續增長。然而，鑒於我們行業的週期性，概不保證市場需求將得以持續。見「風險因素—有關我們業務及行業的風險—我們的業務受半導體行業週期性的影響。行業下行或供給過剩期間可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響」。

### 關稅、貿易限制及出口管制的影響

#### 美國關稅的影響

於2025年12月23日，美國貿易代表辦公室宣布將對自中國進口的半導體加徵301條款關稅，初始關稅稅率為零，並將於18個月後(即2027年6月23日)上調，具體稅率將不遲於該日期前30天公布。於2025年2月1日，特朗普總統對中國進口至美國的所有產品徵收10% IEEPA關稅。於2025年4月2日，特朗普總統對包括中國在內約60個國家實施雙層對等關稅(「對等關稅」，連同301條款關稅及IEEPA關稅，統稱「該等關稅」)，其包括10%的基準稅率及根據各國對美貿易逆差的附加個別關稅。經數輪調整後，仍維持對自中國進口的貨品徵收10%的對等關稅，惟額外24%關稅已於2026年11月10日東部標準時間上午12時01分前暫停。於美國最高法院作出裁決後，按照美國政府發布的行政命令及通知，根據IEEPA徵收的關稅已於2026年2月24日失效，取而代之，將徵收10%的臨時關稅，為期150天。因此，截至最後實際可行日期，於IEEPA項下的關稅取消後，美國對自中國進口的商品徵收的新關稅為10%，且可能進一步變動。

## 業 務

誠如美國出口管制及制裁法律顧問所告知，考慮到：(i)於往績記錄期間，我們並無任何直接出口至美國的產品，且據我們所深知，我們並無向美國作出任何間接銷售；(ii)自徵收該等關稅以來，概無客戶取消與我們的訂單，我們的訂單量、產品價格、客戶付款或物流安排亦無因美國關稅問題而出現任何重大不利變動，概無將關稅轉嫁予客戶，且董事預期該等關稅不會對我們的業務運營或財務表現產生任何直接或間接重大不利影響。經計及美國出口管制及制裁法律顧問的意見，並基於獨家保薦人所進行盡職審查，獨家保薦人並無發現任何事宜致使其不同意董事上述觀點。

我們正密切關注美國關稅發展，並相應調整我們的運營及採購策略。主要措施包括：於中國、東亞及歐洲等多個地區多元化發展客戶及市場基礎，加強與當地供應商合作以穩定生產，與主要客戶保持緊密溝通，並透過持續情景監測制定應急方案。我們亦委聘外部法律顧問追蹤貿易措施，確保全面遵守出口管制、海關及制裁規定。

### 美國出口管制的影響

根據出口管理條例，來自工業與安全局的許可證可能對涉及出口、再出口或在國內轉讓受出口管理條例規管的任何項目(包括商品、軟件及技術)提出要求。受出口管理條例規管的項目不僅包括在美國境內製造或位於美國境內的項目，亦包括若干外國製造的項目。此外，出口管理條例下的最新進展(包括「超級計算機及半導體製造最終用途」限制)旨在限制中國獲得先進計算及半導體製造技術。自2022年10月起，出口管理條例第744.23條向知悉或有理由知悉擬用於超級計算機或半導體製造最終用途的若干出口管理條例管制項目的出口商、再出口商或轉讓人施加許可要求，並隨著時間的推移分階段實施。

誠如美國出口管制及制裁法律顧問所告知，鑒於我們採購項目的性質、我們代工的產品及其擬定最終用途，董事認為超級計算機及半導體製造最終用途限制不大可能對我們的業務運營造成重大不利影響，理由如下：

- (i) 於往績記錄期間，我們的原材料及設備主要自中國及除美國以外其他國家的供應商採購，僅有小部分採購涉及美國原產產品(包括原材料、設備及軟件)，於2023年、2024年及2025年合共佔銷售成本總額的21.7%、16.7%及11.8%；及
- (ii) 於往績記錄期間的所有美國原產採購中：(a)我們所採購的所有美國原產原材料均為出口管理條例項下的低管控項目，一般毋須取得出口、再出口或轉讓許可，惟若目的地為禁運或受制裁國家、受關注終端用戶，或涉及禁止的最終用途則除外；(b)就生產設備而言，於往績記錄期間，我們採購若干美國原產設備用於我們的晶圓代工業務。該設備並非晶圓代工不可替代的核心生產設備，且倘任何供應商未能取得所需出口許可證，我們亦有能力以相若價格向與我們保持長期合作關係的多家國內設備製造商採購替代設備；及(c)就生產軟件而言，我們採購若干美國原產軟件，主要用於物理驗證、電路模擬、參數設備開發及電路設計相關用途。該軟件一般按多年(通常為期三年)授出許可證，

## 業 務

截至最後實際可行日期，由於我們與相關供應商的長期合作關係，我們在獲取或重續有關許可證方面並無遭遇任何重大困難。我們並不知悉有任何跡象表明在日常業務過程中將無法重續該等許可證，即使相關出口管制政策發生變動，我們已物色市場上可獲得的替代非美國軟件解決方案。

就生產設備及軟件而言，概無適用於向我們供應該等項目的出口管制許可規定，或我們的供應商已自相關主管部門獲得向我們合法出口所需的出口許可證(如適用)。該等需要出口許可證的採購(如有)主要發生在我們的量產及產能提升階段，預期不會在我們日常採購活動的過程中再次發生。於往績記錄期間，所有美國原產設備及軟件的採購均遵照出口管理條例進行，包括適用的許可、最終用途及最終用戶規定。該等設備及軟件並不構成整體資本支出的最大組成部分，而我們的核心晶圓代工能力及技術能力繼續由多個供應來源支持。因此，該等採購預期不會對我們的持續經營產生任何重大影響。

倘我們因貿易限制政策變動而無法繼續採購特定美國原產設備或軟件，我們已物色替代供應商，包括非美國來源及國內供應商。儘管採用替代設備或軟件可能涉及額外的驗證、集成及培訓工作，並視具體情況產生增量成本及數個月的調整期，惟董事認為任何該等過渡措施均不會對我們的產能、業務運營或財務表現產生重大不利影響。

經計及美國出口管制及制裁法律顧問的意見，並基於獨家保薦人所進行盡職審查，獨家保薦人並無發現任何事宜致使其不同意董事上述觀點。

此外，誠如美國出口管制及制裁法律顧問所告知，截至最後實際可行日期，本集團並無被列入美國實體清單或任何其他美國出口管制限制名單。見「風險因素—有關我們業務及行業的風險—我們的運營可能會受到國際貿易政策、出口管制及經濟制裁、地緣政治及貿易保護措施的影響」。於往績記錄期間，我們自美國或其他司法權區採購生產材料時並無面臨任何重大困難。我們的供應商並無告知我們供應安排的任何變動或中斷。我們的採購、研發及拓展活動已正常進行。此外，我們繼續努力就大多數美國原產進料物色替代供應商並確定其資格，以進一步降低潛在供應風險。

我們已制定及實施內部出口管制合規措施以確保遵守適用的貿易限制及制裁，包括供應商及交易對手篩選、風險評估、最終用途及最終用戶確認、內部審批程序以及記錄保存。

截至最後實際可行日期，我們並無因關稅、貿易限制或制裁相關事宜產生任何額外合規成本而對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。該等合規成本對於我們的整體運營而言並非重大。我們在必要時投入人員、系統及

## 業 務

外部專業人士支持等額外資源，以應對不斷變化的出口管制及貿易合規事宜以及監管要求。我們將繼續監察監管發展，並根據適用法律及法規的變動適時更新我們的合規政策及程序。

### 國際制裁的影響

工業與安全局公布各種貿易限制清單，指定受指定項目出口或轉讓的特定許可證要求規限的人士、實體或政府。海外資產控制辦公室存置的主要制裁清單為特別指定國民清單，其包括美國政府釐定涉及威脅或破壞美國國家安全或外交政策目標的活動的人士。特別指定國民清單上指定人士的資產被封鎖，且美籍人士通常被禁止與彼等進行交易。

我們的美國出口管制及制裁法律顧問認為，本集團於往績記錄期間的業務(特別是與客戶及供應商等交易對手的業務往來)並不構成主要制裁活動或次要制裁活動，理由如下：(i)我們於中國大陸設有多個國內辦事處，並在日本設有1家研究中心，概無機構位於、註冊成立、組織運作或登記於受相關制裁機關實施全面制裁的國家或地區；(ii)本公司及其任何附屬公司或代表、各自的股東均非被制裁目標，亦未位於受相關制裁機關實施全面制裁的國家或地區；及(iii)本公司並未被相關司法權區任何國民擁有50%以上權益或受其控制。

根據自2019年以來實施的交易對手審查，其中3名我們的客戶(「**相關客戶**」)被列入工業與安全局實體清單且未附註任何註記，另有11家供應商(「**相關供應商**」)被列入工業與安全局實體清單。於2023年、2024年及2025年，來自相關客戶的總銷售收入分別約為人民幣103.5千元、零及零，佔往績記錄期間各年度總收入不足0.1%。於2023年、2024年及2025年，我們就相關供應商產生的總採購成本分別約為人民幣167.4百萬元、人民幣281.2百萬元及人民幣1,228.9百萬元，佔各相同期間總成本約0.9%、2.5%及9.1%。相關交易金額微不足道，且未曾向相關客戶出口或轉讓受出口管理條例規限的物品。同理，我們向相關供應商採購的項目概未涉及出口管理條例規限的物品，亦未違反適用出口管制法規。

儘管上述交易金額微不足道，惟我們意識到倘本集團出售或採購的項目因被列入實體清單或更廣泛的出口管制制度而須受出口管理條例及額外的許可要求、禁令或限制規限，我們提供服務或採購若干項目的能力可能會受到影響。因此，儘管過往交易規模有限，我們在與相關客戶及相關供應商進行交易時已保持審慎，以確保持續遵守適用的出口管制要求。為降低與相關客戶及相關供應商交易所產生的潛在風險，我們進行出口管制核查，遵守供應商及客戶的貿易要求，透過外部顧問監測法規變動，並保持多元化的客戶及供應商群體，以減少對任何受嚴格控制規限的交易對手的依賴。

董事認為，考慮到所涉及交易規模有限、已建立的合規框架及多元化的交易對手，我們面臨的貿易限制及制裁相關風險處於可控範圍內，且預期不會對我們的業務運營或財務表現造成重大不利影響。我們將持續加強合規體系，監察相關司法權區的監管及政策發展，並與供應商、客戶及外部顧問緊密合作，以確保持續遵守適用的出口管制及制裁法律。

## 業 務

我們已實施制裁與出口管制合規措施，旨在系統性審查並確保持續遵循下列核心原則：(i)及時確認交易對手是否被相關制裁機關列為被制裁目標；(ii)確保相關交易不會觸發任何國際制裁風險；及(iii)驗證我們的產品未直接銷售，且據我們所深知亦未間接銷售至任何可能觸發任何國際制裁風險的國家或地區。

因此，我們認為於往績記錄期間並未從事任何受制裁活動，且上述交易並無亦不會對我們的業務運營、財務狀況或未來前景造成重大不利影響。我們將持續監控相關發展並強化合規程序，以確保遵守適用法律及法規。

### 其他司法權區的關稅、出口或貿易管制制度

我們的收入主要來自中國大陸及中國台灣，於2023年、2024年及2025年，來自其他國家及地區(主要為中國香港及新加坡)的收入分別佔總收入的7.5%、5.4%及8.1%。見「業務－營銷、銷售及客戶」。於往績記錄期間，我們並無向美國、歐洲或日本客戶作出任何直接銷售。於往績記錄期間，我們於海外銷售方面並無面臨重大困難，且海外市場保持穩定。根據我們的評估，於往績記錄期間，概無對貿易構成重大影響的關稅、出口限制或其他貿易管制措施適用於我們的海外銷售。

於往績記錄期間，我們於日常業務過程中與歐洲及日本供應商進行採購交易，主要與用於晶圓代工的生產設備及配套設備、光刻膠、生產用氣體及其他耗材有關。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未因關稅調整或海關相關措施而導致採購成本出現任何大幅上升或供應鏈中斷(倘適用)。

就出口管制制度而言，我們自歐洲及日本採購的若干設備及材料須遵守相關司法權區的適用出口管制規定。我們與該等供應商的採購活動乃按常規及經常性基準開展並於日常業務過程中進行。根據我們可得的資料，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未遭遇供應商無法取得所需出口許可，或因出口管制措施導致採購出現重大延遲、受限或不利影響的情況。

我們已實施內部流程，確保遵守適用關稅及出口管制規定，包括對照受限方清單篩查供應商、核驗所採購項目屬生產自用、取得並審閱終端用戶及最終用途聲明(倘適用)及委聘外部法律或專業顧問(倘需要)。據我們經作出合理查詢後所深知，於往績記錄期間，我們並無嚴重違反適用關稅或出口管制規定。於適當情況下，我們嚴格遵守供應商施加的貿易合規要求，包括合規相關聲明、條件及義務，以強化適用關稅及出口管制規定方面的合規情況。

### 風險管理及內部控制

我們已建立穩健的風險管理及內部控制系統，並持續加強該系統以確保業務運營合規。我們定期檢討及更新內部控制機制，以維持其足夠有效。此外，我

## 業 務

們定期評估風險管理政策及內部控制措施，確保其符合運營需求及監管規定。

我們的財務管理涵蓋會計、預算編製、報告以及現金與資產的內部控制，並輔以明確的職責區分以及嚴謹的批准及審查程序。我們制定政策以指導預算編製、預測、投資及現金管理，並提供持續培訓以確保財務運作專業合規。我們的合規框架監測監管變更，執行反欺詐、反賄賂、反洗錢及制裁控制，並包括定期培訓、完善的合規事宜處理程序，以及舉報人保護機制。我們亦維持全面的知識產權政策，恆常審計知識產權資產，實施程序以偵測及處理侵權行為，並要求全體人員簽署保密及知識產權保護協議。我們的人力資源管理政策涵蓋招聘、入職、績效管理、報酬、福利及紀律事宜，對員工數據實施嚴格管控，提供定期培訓，設立反饋及舉報渠道，並致力於促進多元、公平及共融。審計委員會監督財務報告及內部控制，與內部審計部合作評估系統成效，並就重大事項向董事會匯報。

### 執照、許可證及批准

我們的業務需要取得各種執照、許可證、批准及證書。據中國法律顧問告知，我們已從適用機關取得對於我們在中國的運營而言屬重大的必要執照、許可證、批准及證書，且截至最後實際可行日期，該等執照、許可證、批准及證書均為有效及存續。

下表載列截至最後實際可行日期於中國的重大執照及許可證詳情：

編號	證書名稱(編號)	發證機關	有效期
1	輻射安全許可證 (皖環輻證A0390) .....	安徽省生態環境廳、合肥市生態環境局	有效期至 2027年5月21日
2	排污許可證 (91340100343821433Q001W) .....	合肥市生態環境局	2022年1月4日至 2027年1月3日
3	對外貿易經營者備案登記表 .....	-	-
4	高新技術企業證書 (GR202334006863) .....	安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、 國家稅務總局安徽省稅務局	2023年12月7日至 2026年12月6日

我們不時重續執照、許可證、批准及證書，以遵守相關法律及法規。據中國法律顧問告知，重續我們運營所需的執照、許可證、批准及證書並無任何重大法律阻礙。

### 法律程序及合規

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們不曾且並無捲入任何重大法律、仲裁或行政程序，亦不知悉針對我們或董事的任何待決或構成威脅的法律、仲裁或行政程序而個別或共同對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，除下文所披露者外，我們不曾且並無涉及任何不合規事件而導致罰款、執法行動或其他懲罰而可能個別或共

## 業 務

同對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。董事認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們於所有重大方面均遵守我們運營所在司法權區的所有相關法律及法規。

### 社會保險及住房公積金

於往績記錄期間，我們並無為非中國大陸僱員繳納社會保險及住房公積金供款，主要原因為大多數台灣僱員傾向於參加中國台灣的勞工及健康保險計劃。因此，我們委託第三方人力資源代理協助於中國台灣處理有關供款。於2023年、2024年及2025年，我們的社會保險差額分別為人民幣19.3百萬元、人民幣19.2百萬元及人民幣18.7百萬元，而住房公積金供款差額分別為人民幣5.6百萬元、人民幣5.6百萬元及人民幣5.7百萬元。於2023年、2024年及2025年，由第三方人力資源機構支付的金額分別為人民幣8.5百萬元、人民幣8.2百萬元及人民幣8.1百萬元。

我們獲中國法律顧問告知，根據中國相關法律及法規，若我們未能按要求的足額繳納社會保險供款，我們可能被責令於規定期限內支付拖欠的社會保險供款，並按日加收拖欠供款金額0.05%的滯納金。逾期仍不繳納的，主管機關可進一步處以拖欠金額一倍至三倍的罰款。我們獲中國法律顧問進一步告知，根據中國相關法律及法規，政府部門鼓勵企業為非中國大陸僱員繳納住房公積金，惟並無強制要求。據中國法律顧問告知，根據於2002年頒布並於2019年修訂的《住房公積金管理條例》，「職工」指與用人單位於中國境內建立勞動關係的人員。根據建設部於2006年發布的政策說明，外方及港、澳、台人員就前述條例而言不被視為「職工」，因此不納入強制繳存住房公積金的範圍。中國有關部門發布的後續政策進一步闡明，依法於中國境內就業的外籍人員及港澳台居民可自願參加住房公積金制度，並在選擇參加後享有與中國職工同等的待遇。該等政策體現便利與支持性的方針，而並非對用人單位施加任何為非中國大陸僱員繳存住房公積金的強制義務。因此，在現行中國法律及監管框架下，用人單位並未被強制要求為非中國大陸僱員繳納住房公積金。

因此，住房公積金部門不會要求我們為該等員工作出追溯性供款。逾期仍不繳納的，可向中國法院申請強制執行。根據與相關主管機關的訪談，若我們在相關主管機關規定的時限內結清社會保險及相關滯納金，則我們被相關主管機關處以行政處罰的風險甚微。

中國法律顧問已進行獨立查冊，並確認我們於往績記錄期間並無因未能根據相關法律及法規足額繳納社會保險供款或住房公積金而受到任何行政處罰。此外，中國法律顧問的公開信息查冊顯示，並無事例表明社會保險或住房公積金機關因個別僱員投訴或舉報而要求我們為所有僱員補繳過往款項。此外，中國法

## 業 務

律顧問與相關主管機關進行訪談，主管機關已確認(i)倘我們按要求及時補足任何供款差額及滯納金，施加處罰的可能性甚微；(ii)即使僱員就社會保險提出投訴，有關機關亦不太可能要求足額支付過往款項；及(iii)就住房公積金投訴而言，開展任何調查前會先進行調解程序。再者，根據中國法律顧問基於上述情況的建議，在並無重大僱員投訴的情況下，受到重大行政處罰或追繳過往欠款的可能性甚微。因此，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無糾正有關差額情況，亦無就社會保險及住房公積金供款差額計提任何準備。

另外，據中國法律顧問告知，鑒於中國最高人民法院於2025年7月31日頒布並於2025年9月1日生效的《最高人民法院關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(二)》(「**解釋**」)第19(1)條，用人單位與勞動者約定或者勞動者向用人單位承諾無需繳納社會保險費的，人民法院應當認定該約定或者承諾無效。此外，用人單位未依法繳納社會保險費，勞動者根據《中華人民共和國勞動合同法》第三十八條第三項規定請求解除勞動合同、由用人單位支付經濟補償的，人民法院依法予以支持，在此情況下，儘管有任何先前放棄社會保險供款的協議，僱主仍須向僱員支付經濟補償(按僱傭年數乘以月薪計算)。見「**監管概覽—有關勞動用工的法規—社會保障與住房公積金**」。

董事認為，且中國法律顧問同意，解釋不會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響，當中計及：(i)解釋的實施不會影響我們在社會保險及住房公積金供款方面的合規狀況，原因為上述司法解釋並無廢止中國現時生效的社會保險法律及法規；(ii)解釋不會就重新評估供款差額或使我們面臨更高處罰創造任何新基礎；(iii)並無僱員就社會保險支付提起訴訟或仲裁，因此本公司並無未決訴訟或仲裁適用於上述司法解釋；及(iv)任何社會保險或住房公積金供款差額均已納入差額計算中。按此基準，獨家保薦人概不知悉有任何事宜令獨家保薦人不同意上文董事及中國法律顧問的意見。

我們已透過加強人力資源管理政策來強化內部控制，確保社會保險及住房公積金供款嚴格遵循當地要求，完善員工合規事宜培訓，並定期監測中國法律及法規的最新發展。此外，我們諮詢中國法律顧問，並與當地社會保險及住房公積金管理機構保持積極溝通，以掌握監管動態並確保持續合規。

未來，我們承諾於[**編纂**]後遵守相關法律及法規，並在相關主管機關要求時進行糾正。見「**風險因素—有關我們行業及業務的風險—我們可能因身為中國大陸以外國家／地區居民的僱員的社會保險覆蓋範圍而面臨中國法律及法規的合規風險以及潛在處罰**」。